

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2026-040

气派科技股份有限公司

关于对上海证券交易所《关于气派科技股份有限公司 2025 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”或“气派科技”）于 2026 年 6 月 15 日收到上海证券交易所下发的《关于气派科技股份有限公司 2025 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2026】0338 号）（以下简称《问询函》），根据《问询函》的要求，公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”），对问询函所列问题进行了认真核查并作出如下回复。

说明：本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

一、关于业绩下滑

年报显示，2022 年至 2025 年公司连续亏损，各年归母净利润分别为-5,856.03 万元、-13,096.69 万元、-10,211.37 万元、-7,538.40 万元。单季度看，2025 年第四季度公司净利润 128.48 万元，系 2022 年第三季度以来首次实现单季度盈利；2026 年第一季度，公司再次转亏。截至 2025 年末，公司未弥补亏损 5,665.80 万元，净资产 61,641.55 万元。

请公司：（1）结合行业周期、下游需求、技术迭代、市场竞争、产品及客户结构等，详细分析公司持续亏损的原因，说明公司持续经营能力是否存在重大

不确定性；（2）分析 2025 年第四季度公司盈利的原因，说明是否依赖于偶发性、非经常性因素，并分析扣除上述因素后的盈利情况，盈利能力是否发生实质性改善；（3）说明公司已采取和拟采取的改善经营业绩的具体措施（如产品结构优化、客户拓展、成本控制、资产处置等），并量化分析相关措施预计产生效益的时间、金额及可实现性；（4）列示 2025 年第四季度前五大客户、合作历史、2025 年各季度销售金额、第四季度末应收账款余额、期后回款及退换货情况等；（5）结合 2025 年第四季度及 2026 年第一季度发货及验收时点、收入确认依据、成本费用归集期间、期后回款及退换货情况，核实并说明 2025 年第四季度是否存在突击确认收入、推迟确认成本费用以及跨期调节利润等情形，请年审会计师详细说明针对收入成本费用所执行的截止性测试、细节测试情况。

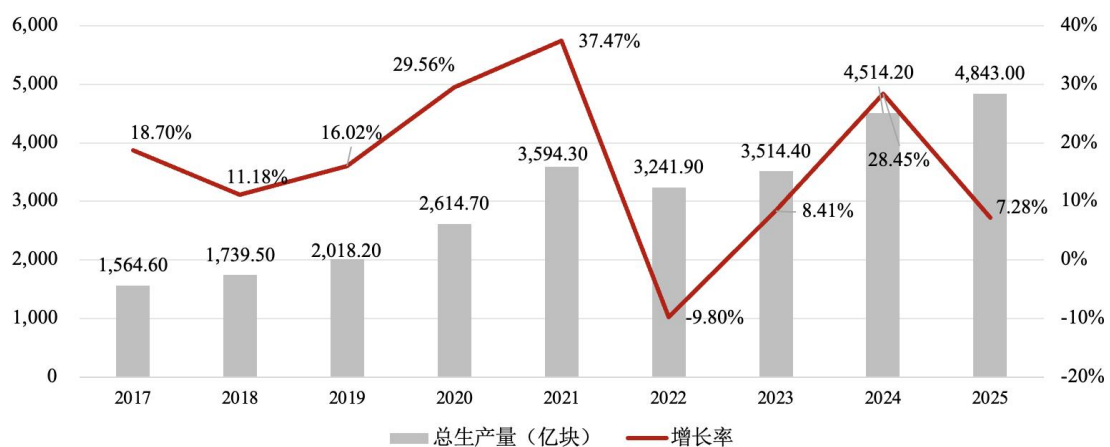
回复：

（一）结合行业周期、下游需求、技术迭代、市场竞争、产品及客户结构等，详细分析公司持续亏损的原因，说明公司持续经营能力是否存在重大不确定性

1、行业周期及下游需求

2022 年至 2025 年，公司所处半导体封装测试行业整体呈现周期性波动特征，行业周期变化与下游需求变化具有较强联动关系。2022 年以来，受全球宏观经济波动及终端消费电子需求下行影响，行业进入调整阶段，下游需求收缩带动产业链进入去库存周期，行业整体盈利水平承压。

中国集成电路产业产量增长情况



注：数据来源于国家统计局。

从行业数据来看，中国集成电路产业产量由 2021 年的 3,594.30 亿块变动至 2022 年的 3,241.90 亿块，同比下降约 9.80%；2023 年产量约 3,514.40 亿块，同比增长约 8.41%；2024 年产量约 4,514.20 亿块，同比增长约 28.45%；2025 年产量约 4,843.00 亿块，同比增长约 7.28%，整体呈现先调整后恢复的周期性变化特征。

在行业周期波动背景下，下游需求与行业景气度保持一致变化趋势。2022 年以来，下游消费电子需求走弱带动客户需求整体收缩，订单释放节奏放缓；2023 年以来，行业逐步进入修复阶段，下游需求有所恢复但仍处于调整与修复并存阶段；2024 年至 2025 年，随着库存去化逐步完成，下游整体需求水平逐步回升，但恢复过程仍存在阶段性波动。受行业周期及下游需求恢复影响，公司收入端改善受到行业传导节奏影响，恢复进程呈现一定滞后性。

2、技术迭代

半导体封装测试行业属于技术密集型行业。随着终端应用向小型化、智能化、高性能及高可靠性方向发展，封装测试技术持续演进，QFN/DFN、LQFP、LGA、FC、CSP、WLCSP、MCM、SiP 等中高端及先进封装形式的应用范围逐步扩大，行业整体呈现传统封装与中高端、先进封装并行发展的趋势。

公司主要产品包括 SOT、SOP、DFN/QFN 系列产品，2023 年度至 2025 年度上述产品合计销售收入占主营业务收入的比例分别为 87.38%、88.60%和 88.93%，已形成覆盖传统封装及中高端封装的产品体系。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计拥有境内外专利 316 项，其中发明专利 56 项，具备较强的技术积累和知识产权基础。

公司常规封装测试产品主要包括 SOP、SOT 等系列产品，主要应用于消费电子、智能家居、工业控制等终端领域，具有性价比高、产品通用性强、使用成本低、应用领域广等特点。该类产品的封装技术、封装工艺及可靠性要求已较为成熟，市场需求呈现稳定增长趋势。行业技术迭代主要体现为不同应用场景下集成度、散热性能及可靠性要求的持续提升，并不必然带来封装形式的替代，即 SOP、SOT 等常规封装形式在未来的较长时间内也不会被先进封装形式替代。因此，公

司常规封装测试产品短期内不存在因技术快速迭代导致产品竞争力下降的重大风险。

公司主要中高端封装测试产品为 QFN/DFN 系列产品。近年来，QFN/DFN、LQFP、LGA、FC、CSP、WLCSP、MCM、SiP 等中高端封装测试产品的应用范围逐步扩大，相关技术路线已趋于成熟或已形成较为明确的发展方向。该等产品的技术演进主要体现为工艺优化、产品性能提升及应用领域拓展，并非基础技术路线的重大变化。因此，中高端封装测试产品短期内不存在明显的技术迭代风险，公司现有 QFN/DFN 系列产品亦不存在因技术路线重大变化而被快速替代的情形。

总体来看，半导体封装测试行业技术迭代具有渐进式、分层次特征，传统封装与中高端、先进封装在应用领域、成本结构、性能要求及客户需求方面存在差异，未来较长时期内各封装形式产品仍将并存发展。公司现有主要产品所处细分领域技术路线相对成熟，同时公司已在 QFN/DFN 等中高端封装产品方面形成量产能力、客户基础和技术积累，具备跟进行业技术演进的基础，短期内不存在因行业技术迭代导致主要产品被快速替代或持续经营能力受到重大不利影响的情形。

3、市场竞争

相对于芯片设计和晶圆制造产业来说，中国封装测试领域的技术水平和销售规模与国际知名企业的水平持平，以长电科技、通富微电和华天科技为典型代表，作为国内封装测试行业的龙头企业，已居全球封装测试企业前十名。

全球半导体产业经历二次产业转移，目前处于第三次产业转移的进程之中，作为半导体领域壁垒相对较低的领域，封测产业目前主要转移至亚洲区域，主要包括中国大陆、中国台湾、东南亚等。

我国半导体封测行业属于市场化程度较高的行业，衡量行业竞争力的关键指标通常包括技术创新能力、生产效率、产品质量、市场占有率、客户服务能力和供应链整合能力等。

从国内竞争结构来看，行业已形成较为清晰的分层体系，具体如下：

国内半导体封装测试企业类别

类型	主要特征	主要优势	代表厂商
行业内规模或技术具有领先优势的企业	规模大、综合实力强、引领行业技术和产品创新, 高效、严格的品质管理体系; 外资企业以 BGA、CSP、WLCSP、FC、MEMS、Bumping、TSV 等为主, 内资企业在先进封装产品市场已占有一定比例	技术、市场和资金优势	长电科技、华天科技、通富微电及安靠科技、日月光等在国内设立的封装测试企业
具有一定规模、具备较强技术实力的中等规模企业	规模中等、具备较强的技术实力和完整的品质管控体系, 专注于技术工艺创新, 以 SOT、SOP、QFP、QFN/DFN、LQFP 等系列产品为主, 逐步向 CSP、FC、TSV、SIP 等先进产品延伸	拥有较强的研发和技术能力, 具有完善的生产与质量管理体系; 产品性价比高、竞争力强	以气派科技、华宇电子等为代表的中等规模企业
规模较小的企业	规模较小、技术或生产管理一般, 主要以 TO、DIP、SOP 等产品为主	无明显优势	数量众多的中小型企业

从上可知, 目前国内综合性封装测试市场形成了较为明显的三个层次, 长电科技、华天科技、通富微电等全球性知名企业, 其市场开拓重心逐步转移至 SIP、TSV、WLCSP 等先进封装领域, 气派科技、华宇电子等具有一定规模、较强技术实力的中等规模企业, 目前以常规和中高端封装产品为主, 逐步向先进封装领域延伸; 除此以外, 还存在数量较多的规模较小、技术能力一般的中小型企业, 该等企业以常规封装产品为主。

从具体封装形式产品来看, 长电科技、通富微电、华天科技等头部企业重心向先进封装形式产品转移, 其在先进封装产品领域市场竞争能力强, SOP、SOT 等常规封装形式产品甚至 QFN/DFN 等中高端封装形式产品投入力度不大 (甚至已不再投入); 气派科技、华宇电子等中等规模企业因具备较大规模、具备较强技术实力, SOP、SOT、QFN/DFN 等产品具备与长电科技、通富微电、华天科技等头部企业同等的技术实力, 在成本管控等方面具备一定竞争优势。

从封装测试市场来看, 常规封装产品市场竞争较为激烈, 在行业景气度下行时竞争程度会进一步加剧; 相较常规封装产品, 先进封装测试产品市场竞争相对较好。

4、产品及客户结构

2023 年度至 2025 年度，公司主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

产品名称	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
SOT	24,357.07	33.08%	18,633.74	29.72%	17,750.45	34.05%
SOP	15,941.50	21.65%	16,813.43	26.82%	14,099.48	27.04%
DFN/QFN	25,181.57	34.20%	20,099.06	32.06%	13,703.89	26.29%
CPC	2,163.56	2.94%	2,073.02	3.31%	2,057.07	3.95%
LQFP	529.65	0.72%	577.92	0.92%	937.92	1.80%
其他	4,716.29	6.41%	4,193.50	6.69%	3,484.45	6.68%
晶圆测试	744.79	1.01%	309.45	0.49%	100.57	0.19%
合计	73,634.44	100.00%	62,700.12	100.00%	52,133.82	100.00%

从产品结构来看，公司收入主要来源于 SOT、SOP 及 DFN/QFN 等封装产品，其中中高端封装产品 DFN/QFN 产品收入占比逐年提升，2023 年度至 2025 年度分别为 26.29%、32.06%及 34.20%。

公司产品结构布局多元，除传统 SOT、SOP 系列外，在 DFN/QFN 封装体系中已形成多规格、多尺寸产品组合，能够覆盖不同功率及应用场景需求，体现出公司在封装工艺兼容性产线柔性化配置方面的能力。

公司客户主要为芯片设计企业，半导体封装测试行业下游客户由于终端应用场景较多、芯片品类及封装规格差异较大，封测企业通常服务于较多客户，客户结构相对分散。较为分散的客户结构有助于降低单一客户需求波动对公司经营业绩的影响，增强公司订单获取及收入来源的稳定性。2023 年度至 2025 年度，公司前五名客户情况如下：

单位：万元

2025 年度				
序号	客户名称	主要产品应用领域	销售金额	占比
1	南京微盟电子有限公司	消费电子、工业控制、汽车电子、智能家居等	8,309.80	10.81%

2	普冉半导体(上海)股份有限公司	消费电子、智能家居、工业控制、物联网等	5,001.09	6.51%
3	深圳英集芯科技股份有限公司	消费电子、智能终端、无线通信、汽车电子等	4,152.07	5.40%
4	河北博威集成电路有限公司	通信电子、工业控制、汽车电子、消费电子等	3,211.19	4.18%
5	芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司	移动终端、汽车电子、工业控制、数据中心等	3,067.52	3.99%
合计			23,741.68	30.89%
2024 年度				
序号	客户名称	主要产品应用领域	销售金额	占比
1	南京微盟电子有限公司	消费电子、工业控制、汽车电子、智能家居等	5,457.17	8.19%
2	普冉半导体(上海)股份有限公司	消费电子、智能家居、工业控制、物联网等	4,373.48	6.56%
3	晟矽微电子(南京)有限公司	消费电子、智能家居、工业控制、小家电等	3,049.46	4.57%
4	河北博威集成电路有限公司	通信电子、工业控制、汽车电子、消费电子等	2,845.76	4.27%
5	钰太科技股份有限公司	消费电子、智能音频、智能终端、物联网等	2,834.70	4.25%
合计			18,560.58	27.84%
2023 年度				
序号	客户名称	主要产品应用领域	销售金额	占比
1	钰太科技股份有限公司	消费电子、智能音频、智能终端、物联网等	5,070.44	9.15%
2	南京微盟电子有限公司	消费电子、工业控制、汽车电子、智能家居等	3,962.65	7.15%
3	普冉半导体(上海)股份有限公司	消费电子、智能家居、工业控制、物联网等	2,572.15	4.64%

4	晟矽微电子（南京）有限公司	消费电子、智能家居、工业控制、小家电等	2,147.93	3.88%
5	美芯晟科技（北京）股份有限公司	消费电子、智能家居、工业控制、汽车电子等	2,051.92	3.70%
合计			15,805.09	28.51%

2023 年度至 2025 年度，公司前五名客户销售金额合计占比分别为 28.51%、27.84%及 30.89%，整体占比相对稳定，不存在对单一客户或少数客户重大依赖的情形。

2025 年度，公司按销售金额分层的客户构成情况如下：

2025 年销售金额范围	客户数量（家）
大于 1,000 万元	16
500 万元至 1,000 万元	17
50 万元至 500 万元	95
50 万元以下	378
合计	506

由上表可见，2025 年度公司销售金额超过 1,000 万元的客户数量为 16 家，销售金额超过 500 万元的客户数量合计为 33 家，50 万元至 500 万元客户数量为 95 家，客户层次较为丰富，既包括收入贡献较大的核心客户，也包括数量较多的中小客户，客户基础较为广泛。上述客户结构符合半导体封装测试行业客户较为分散的特点，有助于降低单一客户或单一下游应用领域波动对公司经营业绩的影响。

公司客户主要产品应用领域涵盖消费电子、通信、工业控制及汽车电子等终端市场。其中，消费电子相关领域受行业周期波动影响整体需求相对平稳；存储芯片行业呈现显著复苏特征；电源管理及功率器件等领域受益于新能源、AI 算力及汽车电子等新兴应用发展，需求保持增长态势。

公司客户主要产品应用领域涵盖消费电子、通信、工业控制、汽车电子、智能家居、物联网等终端市场，应用场景较为广泛。其中，存储芯片行业呈现复苏

特征，电源管理及功率器件等领域受益于新能源、AI 算力及汽车电子等新兴应用发展，需求保持增长态势。

综上所述，2022年至2025年公司持续亏损主要受半导体封装测试行业周期波动、下游需求阶段性变化、市场竞争加剧及产品结构升级等因素综合影响，同时公司为适应行业向中高端及先进封装方向发展趋势，持续加大产线建设及研发投入力度，上述投入在短期内对公司经营业绩形成一定压力。该等影响主要体现为对公司经营业绩的阶段性影响。

公司目前生产经营活动正常推进，主营业务持续开展，产品结构逐步优化，客户基础较为广泛且前五大客户销售占比整体稳定，订单获取未发生重大不利变化，不存在影响持续经营能力的重大不确定性。

（二）分析 2025 年第四季度公司盈利的原因，说明是否依赖于偶发性、非经常性因素，并分析扣除上述因素后的盈利情况，盈利能力是否发生实质性改善

2025 年第四季度，公司实现营业收入 23,823.90 万元，归属于母公司股东的净利润 128.48 万元，扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 179.71 万元，较前期亏损状态实现单季度由亏转盈。公司 2025 年第四季度盈利主要系下游需求恢复、订单规模增长、产能利用率提升、单位固定成本摊薄以及产品和客户结构优化等因素共同作用所致，具体分析如下：

1、下游需求恢复带动订单规模增长，产能利用率提升推动固定成本摊薄

2025 年第四季度，公司实现营业收入 23,823.90 万元，较 2025 年前三季度单季度平均营业收入 17,684.98 万元增长 34.71%，较 2024 年第四季度营业收入 17,111.04 万元增长 39.23%。从 2025 年内各季度收入变化情况看，公司第一季度至第四季度营业收入分别为 13,161.56 万元、19,429.09 万元、20,464.30 万元和 23,823.90 万元，呈逐季增长趋势，其中第四季度较第三季度增长 16.42%。上述收入增长主要系半导体封装测试行业景气度逐步回升，下游客户订单需求增加，公司订单交付规模扩大所致。

封装测试行业具有重资产投入特征，厂房、机器设备折旧及人工成本等固定或半固定成本占比较高。在收入和产量提升的情况下，公司现有生产线稼动率提

高，固定资产折旧、人工薪酬等固定及半固定成本得到更充分分摊，从而推动单位成本压力下降并改善毛利率水平。2025 年第四季度，公司封装测试产能利用率为 92.67%，较 2025 年前三季度平均封装测试产能利用率 86.65%提升 6.02 个百分点，产能利用率提升对公司 2025 年第四季度毛利率改善及单季度盈利形成积极影响。

2、产品及客户结构优化

2025 年第四季度，随着下游需求恢复及公司产能利用率提升，公司订单承接能力和订单选择空间有所增强。公司在保障主要客户订单交付的基础上，结合客户需求、产品价格、产能安排及订单毛利水平，持续推进产品及订单结构优化。

一方面，公司持续推进 QFN/DFN 中高端封装产品的市场拓展和订单导入。该类产品工艺复杂度、技术要求及产品附加值相对较高，销售定价和毛利水平通常优于部分传统低毛利产品，有助于改善公司整体盈利水平。另一方面，随着订单需求恢复及产能利用率提升，公司对订单的承接选择空间有所改善，能够适当减少承接价格水平较低、毛利率较低的订单，从而降低低毛利产品对整体毛利率的拖累。

受收入规模扩大、产能利用率提升、固定成本摊薄及产品和订单结构优化等因素影响，2025 年第四季度公司毛利率较前期有所改善，并带动当期实现单季度盈利。

3、主要客户合作稳定，订单增长具有持续性

2025 年第四季度，公司订单增长主要来源于既有客户需求恢复、合作客户订单增加以及部分新产品、新客户导入，订单获取与公司长期客户基础、产品交付能力及行业需求恢复相匹配。公司主要客户合作关系较为稳定，相关销售产品与公司主营业务相匹配，不存在依赖单一客户、单笔大额订单或偶发性交易实现盈利的情形。因此，公司 2025 年第四季度盈利主要反映主营业务经营情况阶段性改善，而非依赖偶发性交易或短期非持续性订单。

4、扣除非经常性损益后仍实现盈利，不存在对偶发性、非经常性因素的依赖

2025 年第四季度，公司归属于母公司股东的净利润为 128.48 万元，扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为 179.71 万元，扣非后净利润仍为正且高于归属于母公司股东的净利润，说明公司 2025 年第四季度盈利并非依赖政府补助、资产处置收益等非经常性损益形成，而主要来源于营业收入增长、产能利用率提升、固定成本摊薄及产品和订单结构优化等主营业务改善因素。

2026 年第一季度，公司实现营业收入 22,344.44 万元，同比增长 69.77%，毛利率为 10.57%，较上年同期、2025 年度的毛利率-4.55%、5.33%大幅提升，归属于母公司股东的净利润为-372.46 万元，较上年同期的-3,217.24 万元，同比收窄 88.42%。

综上所述，2025 年第四季度公司实现盈利，主要系行业景气度回升、下游需求恢复带动订单规模增长，同时产能利用率提升、单位固定成本摊薄及产品和客户结构优化共同推动毛利率改善所致。公司 2025 年第四季度盈利主要来源于主营业务经营改善，不存在依赖政府补助、资产处置收益等偶发性、非经常性因素实现盈利的情形；扣除非经常性损益后，公司当期仍实现盈利。公司主营业务已经实质性好转，盈利能力得以实质性改善。

(三) 说明公司已采取和拟采取的改善经营业绩的具体措施（如产品结构优化、客户拓展、成本控制、资产处置等），并量化分析相关措施预计产生效益的时间、金额及可实现性

针对公司持续亏损，公司持续采取多种措施，改善公司的经营状况。具体如下：

1、降本增效

公司在成本控制方面，主要采取了以下措施：

(1) 辅材的降本控制

公司连续两年推出辅助材料降本激励控制，每年设立降本目标与挑战值。运营部门全面分解公司各种辅助材料使用状况与降本方案。万只耗材成本从高峰期的 85.07 元，降低至 2025 年度的 59.40 元，降幅达 30.18%。按 2025 年度 119 亿只入库产量计算，降本约 3,054.73 万元。公司将持续对辅助材料进行跟踪考核管

理，进一步降低使用成本。

(2)人工成本控制

公司自 2025 年初开始进行了人力成本优化，采取人员流动少补、合理优化冗余人员的方式，整体优化人数超过 200 人，并严格设立人员编制管理制度，严控产量增加时的人员增编管理。

按优化人员平均月人工成本 10,000.00 元计算，每年节约人工成本 2,400.00 万元。2024-2025 人工费用占销售收入的比例如下表：

单位：万元

期间	营业收入	人工费总额	人工费占收入的比例 (%)
2024 年度	66,656.25	23,279.63	34.92
2025 年度	76,878.86	23,264.69	30.26

2、产品结构优化

2025 年度与 2024 年度产品结构对比如下表：

单位：万元

项目	2025 年	占比 (%)	2024 年	占比 (%)
常规封装收入	36,309.76	49.81	36,318.27	58.21
中高端封装收入	28,321.26	38.85	23,384.34	37.48
功率器件收入	8,258.62	11.33	2,688.06	4.31
合计	72,889.64	100.00	62,390.67	100.00

从上表可以看出，2025 年度的收入提升主要体现在中高端封装与功率器件产品上。

(1) 大力开拓中高端封装产品

2025 年公司大力开拓中高端封装产品，营业收入同比上年增加了 4,936.92

万元，同比增加 21.11%。

2026 年一季度先中高端装同比 2025 年一季度变动如下表：

单位：万元

项目	2026 年一季度	2025 年一季度	同比增量	增加比例
中高端封装收入	8,517.49	5,079.91	3,437.58	67.67%

由于产能不足的影响，严重制约了公司中高端封装的接单能力，公司正大量投资生产设备，以满足中高端封装的产能需求，预计 2026 年度将有更大幅度的提升。

(2) 功率器件产品的持续增量

功率器件产品作为公司新布局的产品线，自 2024 年下半年起快速上量，2025 年度实现销售收入 8,258.62 万元，同比增长了 207.23%。2026 年一季度销售收入 3,031.49 万元，同比增长 508.60%。

(3) 晶圆测试业务布局成效初显

晶圆测试子公司 2023 年、2024 年、2025 年收入利润如下表：

单位：万元

项目	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 1-5 月
营业收入	119.22	340.74	883.51	786.96
净利润	-329.38	-704.17	-976.53	-32.58

从上可知，公司子公司晶圆测试业务收入快速增长，成效初显。

3、加大客户拓展力度

销售部门制定深挖潜力老客户，大力拓展战略新客户的营销策略。

(1) 优质老客户的深度开拓

对优质老客户,公司采取的措施是努力拓展中高端产品,增加先进封装份额。适当控制竞争激烈的低端产品订单量,实现互利共赢、持续高质量增涨的目标,英集芯、普冉股份等一批优质客户实现了产品多元化合作。

(2) 新客户的开拓

对于战略新客户,公司采用专线管理或类专线管理模式,最大程度满足客户要求,中兴微电子、兆易创新等核心战略新客户,公司分别设立了专线,现处于快速上量阶段。如艾为、南芯等也进入了起量阶段。

(四) 列示 2025 年第四季度前五大客户、合作历史、2025 年各季度销售金额、第四季度末应收账款余额、期后回款及退换货情况等

1、列示 2025 年第四季度前五大客户、合作历史、2025 年各季度销售金额

(1) 2025 年第四季度前五大客户、合作历史

排名	公司	合作历史
1	南京微盟电子有限公司	2012 年
2	普冉半导体(上海)股份有限公司	2016 年
3	芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司	2022 年
4	深圳英集芯科技股份有限公司	2016 年
5	河北博威集成电路有限公司	2013 年

如上表所示,公司 2025 年第四季度前五大客户均是公司 2024 年及以前就开始合作,不存在 2025 年第四季度新增前五大客户。

(2) 2025 年第四季度前五大客户在 2025 年各季度销售金额

2025 年第四季度前五大客户在 2025 年各季度销售金额如下所示:

单位: 万元

公司名称	2025 年第一 季度	2025 年第二 季度	2025 年第三 季度	2025 年第四 季度	2026 年第一 季度
南京微盟电子有限公司	1,206.97	1,954.52	1,892.93	3,255.38	1,997.13

公司名称	2025年第一 季度	2025年第二 季度	2025年第三 季度	2025年第四 季度	2026年第一 季度
普冉半导体（上海）股份有限公司	852.24	1,034.59	1,041.39	2,072.87	1,788.57
芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司	154.89	577.08	875.45	1,460.10	1,798.06
深圳英集芯科技股份有限公司	679.72	1,064.69	1,210.31	1,197.36	1,452.16
河北博威集成电路有限公司	683.94	775.10	731.32	1,020.83	587.79

如上表所示，公司 2025 年第四季度前五大客户在 2025 年各季度的变动趋势基本一致。2025 年呈现逐季度增长的趋势。其中，2025 年第四季度较前几季度增长较多的原因系 2025 年四季度半导体行业复苏，订单量增加所致。2025 年第四季度与 2026 年第一季度相比，除南京微盟电子有限公司、河北博威集成电路有限公司下降较多外，其他客户下降较少或呈现上升趋势，南京微盟电子有限公司 2026 年第一季度销售下降较多的原因系 2026 年 2 月份春节，发货量较少所致，但南京微盟电子有限公司在 2026 年一季度的订单量增长较多；河北博威集成电路有限公司的产品主要是用于 5G 基站的氮化镓射频器件，终端供货渠道高度集中于中兴通讯，客户结构相对单一。经向客户河北博威集成电路有限公司了解，终端客户在 2026 年一季度下的订单偏少；2025 年第四季度前五大客户在 2025 年各季度及 2026 年一季度订单量如下所示：

单位：万只

公司名称	2025年第一 季度	2025年第二 季度	2025年第三 季度	2025年第四 季度	2026年第一 季度
南京微盟电子有限公司	38,369.19	49,346.15	61,997.62	68,364.49	78,020.28
普冉半导体（上海）股份有限公司	14,218.08	20,520.77	26,954.07	31,500.42	30,935.47
芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司	1,604.88	2,466.56	5,373.20	6,444.95	7,363.88
深圳英集芯科技股份有限公司	8,584.43	22,616.21	17,567.46	12,803.37	18,829.73
河北博威集成电路有限公司	327.00	356.64	427.90	394.80	294.68

如上表所示，2025 年第四季度前五大客户除河北博威集成电路有限公司外，2025 年各季度及 2026 年一季度订单量呈现持续增长趋势，河北博威集成电路有限公司的产品主要是用于 5G 基站的氮化镓射频器件，终端供货渠道高度集中于中兴通讯，客户结构相对单一。经向客户河北博威集成电路有限公司了解，终端客户在 2026 年一季度下的订单偏少；综上，2025 年四季度营业收入较前三个季度增加具有合理性。

2、第四季度末应收账款余额、期后回款及退换货情况等

单位：万元

单位名称	第四季度末应收账款余额	期后回款	期后回款率
南京微盟电子有限公司	1,976.25	1,976.25	100.00%
普冉半导体（上海）股份有限公司	775.09	775.09	100.00%
芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司	908.76	908.76	100.00%
深圳英集芯科技股份有限公司	459.57	459.57	100.00%
河北博威集成电路有限公司	504.56	504.56	100.00%

注：期后回款系截止 2026 年 5 月 31 日。

如上表所示，截止 2026 年 5 月 31 日，公司 2025 年第四季度前五大客户应收账款期后回款率均为 100%。2025 年度，公司存在少量的因产品加工质量问题导致的质量赔偿款支出 566.44 万元，不存在退换货的情形。

（五）结合 2025 年第四季度及 2026 年第一季度发货及验收时点、收入确认依据、成本费用归集期间、期后回款及退换货情况，核实并说明 2025 年第四季度是否存在突击确认收入、推迟确认成本费用以及跨期调节利润等情形，请年审会计师详细说明针对收入成本费用所执行的截止性测试、细节测试情况

1、结合 2025 年第四季度及 2026 年第一季度发货及验收时点、收入确认依据、成本费用归集期间、期后回款及退换货情况，核实并说明 2025 年第四季度是否存在突击确认收入、推迟确认成本费用以及跨期调节利润等情形

（1）2025 年第四季度和 2026 年第一季度发货量与收入确认量对比如下：

单位：万只

期间	发货量	收入确认数量	收入确认数量占发货量比
2025 年第四季度	367,344.06	344,442.78	93.77%
2025 年 10 月	118,065.61	87,617.12	74.21%
2025 年 11 月	114,561.59	122,177.24	106.65%
2025 年 12 月	134,716.86	134,648.43	99.95%
2026 年第一季度	330,649.16	311,083.77	88.96%
2026 年 1 月	113,761.31	78,688.83	69.17%
2026 年 2 月	89,469.53	88,581.64	99.01%
2026 年 3 月	127,418.31	126,887.94	99.58%

注：月度收入确认数量是指该季度内发货并确认收入的数量。

如上表所示，2025 年第四季度和 2026 年第一季度收入确认数量占发货量的占比变动不大，且在上述期间内发货并确认收入的数量占比较高，2025 年第四季度不存在突击确认收入的情况。

(2) 验收时点：公司将货物运至客户指定地点，客户进行验收。

(3) 公司收入确认依据为：①对于境内收入，公司将货物运至客户指定地点，经客户验收，并经双方对账无误后确认收入；②对于境外收入，公司将产品装箱后出口，根据出口报关单金额开具出口发票并确认收入。

(4) 公司按照权责发生制原则将成本费用归集到正确期间。2025 年第四季度与 2026 年第一季度成本费用金额及占营业收入比重情况如下所示：

单位：万元

项目	2025 年第四季度		2026 年第一季度	
	金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)

营业收入	23,823.90	-	22,344.44	-
营业成本	20,252.33	85.01	19,982.24	89.43
销售费用	489.16	2.05	500.81	2.24
管理费用	1,337.57	5.61	1,099.66	4.92
研发费用	1,302.12	5.47	1,317.11	5.89
财务费用	710.91	2.98	555.20	2.48

如上表所示，2025 年第四季度和 2026 年第一季度各成本费用占营业收入的比重变动不大，2026 年第一季度营业成本占比较 2025 年第四季度增加，主要系 2026 年 2 月份春节放假，公司产能下降引起的。

(5) 公司 2025 年第四季度前十大客户占比为 53.36%，前十大客户收入确认金额、期后回款及期后退货情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	第四季度收入确认金额	期后回款	期后回款率
南京微盟电子有限公司	3,255.38	1,976.25	100.00%
普冉半导体（上海）股份有限公司	2,072.87	775.09	100.00%
芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司	1,460.10	908.76	100.00%
深圳英集芯科技股份有限公司	1,197.36	459.57	100.00%
河北博威集成电路有限公司	1,020.83	504.56	100.00%
兆易创新科技集团股份有限公司	982.77	615.82	100.00%
天钰科技股份有限公司	755.34	536.67	100.00%
深圳思派微电子有限公司	728.92	769.77	63.41%
江阴江迪金属材料有限公司	631.59	-	100.00%
矽力杰半导体技术（杭州）有限公司	607.83	264.38	100.00%

注：1、期后回款系截止 2026 年 5 月 31 日；

2、公司对江阴江迪金属材料有限公司收入已于 2025 年 12 月 31 日前回款。

如上表所示，截止 2026 年 5 月 31 日，公司 2025 年第四季度前十大客户除深圳思派微电子有限公司外，其他客户期后回款率均超过 90%，不存在退换货的情况。深圳思派微电子有限公司截止 2026 年 5 月 31 日回款率较低的原因主要系该客户受终端客户的影响，回款较慢，但该客户每月陆续回款，2026 年 6 月份已回款 193.23 万元，截止 2026 年 6 月 30 日，回款率为 79.33%。

(6) 2025 年四季度营业收入大幅增长的原因及商业合理性分析

同行业上市公司或挂牌公司 2025 年第四季度营业收入占比如下：

单位：万元

公司简称	2025 年第四季度收入	全年收入	占比
长电科技	1,020,237.57	3,887,134.83	26.25%
华天科技	483,412.58	1,721,391.53	28.08%
通富微电	780,516.58	2,792,142.48	27.95%
甬矽电子	122,841.13	439,836.62	27.93%
华宇电子	23,504.50	81,655.78	28.78%
气派科技	23,823.90	76,878.86	30.99%

如上表所示，同行业上市公司或挂牌公司 2025 年第四季度营业收入占比均超过 25%，与公司 2025 年四季度营业收入占比差异较小。

公司第四季度营业收入占全年营业收入比例为 30.99%，占比较高，从报告期内业务开展情况来看，主要原因系 2025 年下半年半导体行业市场回暖订单增加，同时销售单价略有增加所致，2025 年各季度订单数量、销量及销售单价变动情况如下：

单位：万只、万元、元/只

期间	订单来料数量	生产入库数量	销售数量	封测收入	封测平均单价
2025 年一季度	219,905.60	215,864.29	202,820.11	12,651.27	0.0624
2025 年二季度	315,696.76	288,535.08	309,529.36	18,189.63	0.0588
2025 年三季度	372,329.11	330,133.49	315,101.50	18,697.43	0.0593
2025 年四季度	335,510.68	358,902.28	369,314.77	23,351.31	0.0632

如上表所示，2025 年各季度订单数量分别为 219,905.60 万只、315,696.76 万只、372,329.11 万只、335,510.68 万只，随着半导体市场的回暖，订单数量陆续增加，故 2025 年各季度产量也逐步提升，2025 年各季度销售数量分别为 202,820.11 万只、309,529.36 万只、315,101.50 万只、369,314.77 万只，2025 年三季度订单量高于 2025 年四季度，但销量低于 2025 年四季度主要系三季度部分订单在四季度排产交付所致。如上表所示，2025 年各季度销售单价逐步提升。

综上所述，2025 年四季度收入大幅增加主要系受销量和销售单价的影响，2025 年第四季度不存在突击确认收入、推迟确认成本费用以及跨期调节利润等情形。

2、请年审会计师详细说明针对收入成本费用所执行的截止性测试、细节测试情况。

(1) 对销售费用、管理费用、财务费用进行截止性测试，检查期后费用的支付情况，核查公司费用是否在正确的会计期间确认，我们对截止日 2025 年 12 月 31 日前后 30 日内发生额随机抽样检查，检查费用所计入的会计期间，评价费用是否记录于正确的期间。

(2) 对销售费用、管理费用、财务费用进行细节测试，包括大额合同检查、访谈被审计单位、抽凭检查、应付职工薪酬计提与费用中职工薪酬进行勾稽并进行增减变动分析等，其中，管理费用检查比例 86.61%；销售费用检查比例 84.82%；财务费用检查比例 73.22%。

(3) 对营业收入进行截止性测试，检查期后收款情况，检查公司营业收入是否在正确的会计期间确认，我们对截止日 2025 年 12 月 31 日前后 30 日内发

生额随机抽样进行检查，检查营业收入是否记录于正确的期间。

(4) 对营业收入进行细节测算，包括穿行测试、对客户的背景进行检查、大额合同检查、选取样本对营业收入进行函证、检查支持性证据等，检查比例 79.31%。对营业收入发生额选择样本进行函证；对于未回函的执行替代程序，对于回函不符的编制余额调节表，核实差异原因是否合理。

(5) 对存货及营业成本进行截止测试，检查营业成本的结转情况，检查公司营业成本是否计入正确的会计期间，对营业成本进行倒扎检查，我们对截止日 2025 年 12 月 31 日前后 30 日内随机抽样进行检查，检查存货、营业成本所计入的会计期间是否准确。

(6) 对存货及营业成本进行细节测试，包括采购穿行测试、检查支持性证据、选取样本对采购发生额进行函证，对于未回函的执行替代程序，对于回函不符的编制余额调节表，核实差异原因是否合理。

经上述检查，公司 2025 年第四季度不存在突击确认收入、推迟确认成本费用以及跨期调节利润等情形。

(六) 会计师核查程序

针对上述事项，会计师执行了以下核查程序：

1、结合行业周期、下游需求、技术迭代、市场竞争、产品及客户结构分析公司连续亏损的原因。

2、访谈公司管理层，了解 2022 年至 2025 年连续亏损及 2025 年第 4 季度盈利的原因，公司采取和拟采取的改善经营业绩的具体措施。

3、分析公司 2025 年四季度盈利的原因是否来源于偶发性、非经常性因素，增长是否具有可持续等。

4、获取公司 2025 年各季度和 2026 年一季度销货明细及订单明细，对比分析 2025 年四季度和 2026 年一季度是否有重大差异，是否存在 2025 年第四季度突击确认收入的情况。

5、对期间费用执行分析性程序，包括期间费用结构分析、纵向数据对比分

析、同行业数据对比分析等，了解期间费用变动的原因及合理性。

6、获取期间费用明细表，检查费用明细项目的设置和核算是否符合会计准则相关规定，费用分类是否准确，核算口径是否一致等。

（七）会计师核查结论

经核查，会计师认为：

1、2022 年至 2025 年公司连续亏损主要受半导体封装测试行业周期波动、下游需求阶段性变化、市场竞争加剧、产品结构升级及公司持续进行产线建设和研发投入等因素综合影响，相关影响主要体现为对公司经营业绩的阶段性压力。公司目前生产经营活动正常开展，主营业务持续经营，客户合作及订单获取未发生重大不利变化，资产及现金流状况整体稳定。

2、关于 2025 年第四季度盈利及盈利能力改善，2025 年第四季度公司实现盈利，主要系半导体封装测试行业景气度逐步回升、下游需求恢复、订单规模增长、产能利用率提升及产品结构优化等因素共同作用所致。公司第四季度盈利主要来源于主营业务经营成果，不存在对政府补助、资产处置收益等偶发性、非经常性因素的重大依赖；扣除非经常性损益后，公司盈利水平较前期亏损阶段已有明显改善，盈利能力出现一定修复。

3、公司已采取和拟采取的改善经营业绩的具体措施主要有降本增效、产品结构优化、加大客户拓展力度，通过实施上述措施，公司已取得显著效果；

4、截止 2026 年 5 月 31 日，公司 2025 年第四季度前五大客户应收账款期后回款率接近 100%；因公司是封装测试企业，大部分晶圆均来自自有客户，公司存在少量的因产品加工质量问题导致的质量赔偿款支出，但不存在退换货的情形。

5、公司 2025 年第四季度不存在突击确认收入、推迟确认成本费用以及跨期调节利润等情形。

二、关于主营业务

年报显示，（1）公司主营业务按产品可分为集成电路封装测试、功率器件

封装测试、晶圆测试三类，其中集成电路封装测试和功率器件封装测试按销售模式均可分为客供芯片与自购芯片两种模式。2025 年度，自购芯片功率器件封装测试、自购芯片集成电路封装测试营业收入分别为 1,888.82 万元、541.79 万元，毛利率分别为 3.21%、-17.00%。（2）年报显示，2025 年公司主营业务境内收入 70,388.38 万元，毛利率 1.97%，境外收入为 3,246.06 万元，毛利率 12.71%。（3）公司晶圆贸易收入 610.01 万元，同比下降 61.34%。

请公司：（1）分别列示客供芯片和自购芯片两种模式下，2025 年度前五大供应商和客户的名称、交易金额、定价依据、关联关系等，说明自购芯片封装测试的业务流程及商业背景，并结合同行业公司情况，说明自购芯片封装测试业务模式是否属于行业惯例；（2）说明自购芯片封装测试毛利率较低的原因，以及在毛利率较低的情况下，公司继续开展自购芯片封装测试的商业合理性；（3）说明自购芯片封装测试业务的收入确认方法（总额法或净额法）及依据，是否存在客户指定晶圆供应商、约定晶圆价格或实质由客户承担晶圆价格波动的情况；（4）列示 2023 年至 2025 年境外销售前五大客户名称、注册及经营地区、成立时间、主营业务、合作历史、关联关系、销售产品类型、销售金额、期末应收账款及期后回款情况等，并分析境外毛利率显著高于境内的原因及合理性；（5）说明晶圆贸易业务的商业背景、业务流程、定价政策、毛利率、收入确认方法及依据，以及该业务的后续规划。

回复：

（一）分别列示客供芯片和自购芯片两种模式下，2025 年度前五大供应商和客户的名称、交易金额、定价依据、关联关系等，说明自购芯片封装测试的业务流程及商业背景，并结合同行业公司情况，说明自购芯片封装测试业务模式是否属于行业惯例

2025 年度，公司主营业务按销售模式收入、成本情况如下：

单位：万元

主营业务分销售模式情况				
销售模式	营业收入	占比	营业成本	占比

主营业务分销售模式情况				
自购芯片封装测试	2,430.61	3.30%	2,462.12	3.43%
客供芯片封装测试	70,459.04	95.69%	68,359.91	95.16%
晶圆测试	744.79	1.01%	1,015.85	1.41%
合计	73,634.44	100.00%	71,837.87	100.00%

从销售模式上看，公司封装测试业务的销售模式以客供芯片封装测试为主（占比 95.69%）、自购芯片封装测试为辅（占比 3.30%）。

2025 年度，公司客供芯片前五大客户及其相关情况如下：

单位：万元

2025 年度					
序号	客户名称	销售内容	收入金额	定价依据	是否存在关联关系
1	南京微盟电子有限公司	封装测试	8,306.01	以成本加成为基础，并参考市场定价原则确定各产品的基准价格	否
2	普冉半导体(上海)股份有限公司	封装测试	5,001.09	以成本加成为基础，并参考市场定价原则确定各产品的基准价格	否
3	深圳英集芯科技股份有限公司	封装测试	4,019.08	以成本加成为基础，并参考市场定价原则确定各产品的基准价格	否
4	河北博威集成电路有限公司	封装测试	3,211.19	以成本加成为基础，并参考市场定价原则确定各产品的基准价格	否
5	芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司	封装测试	3,065.91	以成本加成为基础，并参考市场定价原则确定各产品的基准价格	否
合计			23,603.28	-	-

2025 年度，公司客供芯片前五大供应商及其相关情况如下：

单位：万元

2025 年度					
序号	供应商名称	采购内容	采购金额	定价依据	是否存在关联关系

2025 年度					
1	宁波康强电子股份有限公司	引线框、丝材、模具	6,502.52	根据市场行情双方协商沟通	否
2	泰兴市龙腾电子有限公司	引线框、模具	5,059.79	根据市场行情双方协商沟通	否
3	重庆佰仕多化工有限公司	树脂	1,797.31	根据市场行情双方协商沟通	否
4	进峰贸易(深圳)有限公司	引线框	1,561.27	根据市场行情双方协商沟通	否
5	东莞市译码半导体有限公司	减薄划片、胶带	1543.98	根据市场行情双方协商沟通	否
合计		-	16,464.87	-	-

由上表所示，2025 年度公司客供芯片封装测试前五大客户销售收入为 23,610.40 万元，2025 年度公司客供芯片封装测试前五大采购金额为 16,464.87 万元。上述客户及供应商与公司均不存在关联关系，交易价格系根据市场行情经双方协商确定，具有公允性。

由于半导体封装测试企业为重资产型，资产折旧及人工成本等固定成本占比超过 50%，同时封装测试行业具备较强的周期性，行业景气度不同时，行业内企业产能利用率变动幅度很大，为平衡产能、摊薄固定成本，公司在产能富余时会少量开展自购芯片封装测试业务。自公司成立起，公司即已存在自购芯片封装测试业务。

2025 年度，公司自购芯片前五大客户及其相关情况如下：

单位：万元

2025 年度					
序号	客户名称	销售内容	收入金额	定价依据	是否存在关联关系
1	深圳思派微电子有限公司	集成电路	2,015.86	以成本加成为基础，并参考市场定价原则确定各产品的基准价格	否
2	钰太科技股份有限公司	集成电路	201.65	以成本加成为基础，并参考市场定价原则确定各产品的基准价格	否
3	深圳英集芯科技股份有限公司	集成电路	131.28	以成本加成为基础，并参考市场定价原则确定各产品的基准价格	否
4	深圳市爱协生科技股份有限公司	集成电路	22.24	以成本加成为基础，并参考市场定价原则确定各产品的基准价格	否
5	江西省深安电子工业有限公司	集成电路	19.45	以成本加成为基础，并参考市场定价原则确定各产品的基准价格	否

合计	-	2,390.49	-	-
----	---	----------	---	---

2025 年度，公司自购芯片前五大供应商及其相关情况如下：

单位：万元

2025 年度					
序号	供应商名称	采购内容	采购金额	定价依据	是否存在关联关系
1	香港艾博科技有限公司	晶圆	148.19	根据市场行情双方协商沟通	否
2	厦门芯一代集成电路有限公司	晶圆	120.75	根据市场行情双方协商沟通	否
3	深圳市派思迪功率半导体有限公司	晶圆	113.06	根据市场行情双方协商沟通	否
4	常州旺童半导体科技有限公司	晶圆	97.61	根据市场行情双方协商沟通	否
5	合肥六角形半导体有限公司	晶圆	67.00	根据市场行情双方协商沟通	否
合计		-	546.60	-	-

注：自购与客供芯片封装测试除晶圆采购外，其余辅材均为统一采购。

由上表，2025 年度公司自购芯片前五大客户销售收入为 2,390.49 万元，2025 年度自购芯片前五大供应商采购金额为 546.60 万元。上述客户及供应商与公司均不存在关联关系，交易价格系根据市场行情经双方协商确定，具有公允性。

公司自购芯片封装测试的销售流程如下：

在了解客户需求的基础上，公司会自行采购一些通用芯片的晶圆，在公司封装测试产能允许的条件下进行封装测试形成芯片成品，在客户有需求时将这些芯片成品销售给客户，从而平衡公司产能、摊薄成本。客供芯片封装测试由客户提供晶圆芯片，自购芯片封装测试由公司自行采购晶圆芯片；除此以外，公司的客供芯片封装测试和自购芯片封装测试的采购模式、生产模式、销售模式、研发模式没有差别。

公司开展自购芯片封装测试业务，主要基于以下商业逻辑：

(1) 产能平衡的客观需要

封测企业的生产设备和厂房为重资产，固定折旧成本高。当客户委托加工（客供模式）订单相对淡季或存在产能空窗时，公司通过自购晶圆利用剩余产能进行生产，有效分摊固定成本，提高设备利用率，避免产能空置造成的经营损失。

（2）同行业可比公司自购芯片封装测试业务情况

经公开信息查询，蓝箭电子销售自有品牌产品系其通过自行采购芯片以及框架、塑封料等其他材料进行封装测试，为行业终端客户提供多种封装形式的半导体器件产品，其自有品牌产品的2025年收入占比为47.17%。蓝箭电子自有品牌业务与公司自购芯片封装测试业务模式类似。除前述情形外，未见其他同行业公司披露自购芯片封装测试业务情况。

综上，2025年度公司封装测试业务以客供芯片封装测试为主，自购芯片封装测试为补充，收入占比很低。公司两种模式下的主要客户、供应商均与公司不存在关联关系，交易定价依据合理，具有公允性。公司自购芯片封装测试业务主要系基于产能平衡、分摊固定成本之考虑，业务流程与客供芯片封装测试除晶圆来源外不存在重大差异。

（二）说明自购芯片封装测试毛利率较低的原因，以及在毛利率较低的情况下，公司继续开展自购芯片封装测试的商业合理性

2025年度，公司自购芯片封装测试业务收入仅为2,430.61万元，占主营业务收入的比例仅为3.30%。如前所述，公司开展自购芯片封装测试主要目的为平衡产能，摊薄固定成本，提高设备利用率，是公司客供芯片封装测试业务的补充性业务。

公司自购芯片封装测试业务毛利率较低的主要原因为：

1、公司并非专门的芯片设计企业，自购芯片封装测试所生产产品为市场通用常规产品，且整体采购规模较少，议价空间较小，产品价格竞争激烈且公司不分享产品设计环节的利润；

2、受2022年行业景气度影响，半导体封装测试行业产品价格下行且较长时间处于低价水平，公司客供芯片封装测试产品毛利率也较低。

公司继续开展自购芯片封装测试的原因为：半导体封装测试企业为重资产型企业，资产折旧摊销及人工成本等固定成本占比超过50%，同时封装测试行业周

期性较强，行业景气度不同时，产能利用率波动大；在行业景气度高启时，由于客户下单的不连续性等因素，部分时段也可能会有产能富余，因而公司通过少量开展自购芯片封装测试业务以平衡产能、摊薄固定成本，以降低核心主业自购芯片封装测试业务成本分摊压力。

综上所述，公司自购芯片封装测试业务为公司避免产能空置的补充性业务，相关产品为市场通用产品，相应的产品毛利率较低；为平衡产能、摊薄固定成本，公司开展少量自购芯片封装测试业务作为补充性业务具有商业合理性。

（三）说明自购芯片封装测试业务的收入确认方法（总额法或净额法）及依据，是否存在客户指定晶圆供应商、约定晶圆价格或实质由客户承担晶圆价格波动的情况

2025年，公司自购芯片功率器件封装测试、自购芯片集成电路封装测试营业收入分别为 1,888.82 万元、541.79 万元，合计 2,430.61 万元；占营业收入的比重为 3.16%。

公司自购芯片封装测试业务均采用总额法确认收入，具体依据如下：

1、企业是否自第三方取得商品或其他控制权后，再转让给客户

公司支付货款采购第三方的原材料后经过公司检验入库，生产领料，加工完成后发给客户，客户不存在指定供应商的情形，整个过程中公司均具有对原材料的控制权。

2、企业能否主导第三方代表本企业向客户提供服务

公司产品直接卖给客户，如产品有质量问题，均由公司进行售后，不涉及供应商代表公司向客户提供服务的情形。

3、企业自第三方取得商品控制权后，是否通过提供重大的服务将该商品整合成某组合产出转让给客户。

原材料经过正常的生产领料，封装测试为产成品后发给客户，生产成本包含直接材料、直接人工、制造费用。公司并非简单的物料对接或配套服务，而是通

过投入人工、设备、制造费用，对采购的原材料进行一系列加工，形成完整的产品生产价值链，最终发给客户。

4、企业承担向客户转让商品的主要责任

产品交付后，公司对整合产品质量、性能等负全部责任，并独立承担产品售后、退换货等全部履约责任。

5、企业在转让商品之前或之后是否承担该商品的存货风险

产品生产完成后放置在公司成品仓，待客户下单后再发货，在产品转让前产品所有权归公司所有，产品毁损、灭失、品质瑕疵等全部存货风险均由公司承担。

6、企业是否有权自主决定所交易商品的价格

芯片的采购渠道不由客户指定，公司自主负责，同时公司拥有供应商与客户的自主选择权，可根据经营需求自由确定合作的供应商及客户，并且公司自主决定采购价格和产品的销售价格，具有自主定价权。公司不存在客户约定晶圆价格或实质由客户承担晶圆价格波动的情况。

综上所述，公司自购芯片封装测试业务均采用总额法确认收入符合《企业会计准则第 14 号——收入》的有关规定。公司不存在客户指定晶圆供应商、约定晶圆价格或实质由客户承担晶圆价格波动的情况。

（四）列示 2023 年至 2025 年境外销售前五大客户名称、注册及经营地区、成立时间、主营业务、合作历史、关联关系、销售产品类型、销售金额、期末应收账款及期后回款情况等，并分析境外毛利率显著高于境内的原因及合理性

2023年至2025年，公司境外销售前五大客户情况如下：

单位：万元

2025 年度											
序号	客户名称	注册及经营地区	成立时间	主营业务	合作历史	是否存在关联关系	销售产品类型	销售金额	期末应收账款	期后回款情况	回款比例
1	天钰科技股份有限公司	中国台湾	1995/7/4	半导体及相关设备	2019年	否	ESOP、SOP、CPC、SOT、QFN/DFN、晶圆测试	1,511.77	218.95	218.95	100%
2	香港英哲电子科技有限公司	中国香港	2017/11/3	IC 设计，芯片代理	2023年	否	ESOP、SOT、QFN/DFN、MOD	689.36	347.74	347.74	100%
3	富鼎先进电子股份有限公司	中国台湾	1998/7/17	MOSFET、IGBT 和电源管理芯片研发	2024年	否	SOP、SOT、PQFN、TO	390.88	101.75	101.75	100%

4	钰太科技股份有限公司	中国台湾	2005/12/12	感测器元件及其应用晶片组	2022年	否	MOD、SOT	201.65	-	-	100%
5	廣閎科技股份有限公司	中国台湾	2007/11/7	电子、电器批发及工程服务	2021年	否	CPC、DFN/QFN、SOP、SOT、TO	153.83	10.87	10.87	100%
2024 年度											
序号	客户名称	注册及经营地区	成立时间	主营业务	合作历史	是否存在关联关系	销售产品类型	销售金额	期末应收账款	期后回款情况	回款比例
1	天钰科技股份有限公司	中国台湾	1995/7/4	半导体及相关设备	2019年	否	ESOP、SOP、SOT、QFN/DFN、晶圆测试	1,419.93	384.92	384.92	100%
2	钰太科技股份有限公司	中国台湾	2005/12/12	感测器元件及其应用晶片组	2022年	否	MOD、SOT	1,023.63	-	-	100%

3	香港英哲 电子科技有限公司	中国香港	2017/11/3	IC 设计, 芯片代理	2023 年	否	ESOP、SOT、QFN/DFN、 MOD	163.03	193.23	193.23	100%
4	廣閱科技 股份有限公司	中国台湾	2007/11/7	电子、电器批发及 工程服务	2021 年	否	CPC、QFN、SOP	119.69	32.91	32.91	100%
5	通嘉科技 股份有限公司	中国台湾	2002/9/18	高性能电源管理 IC	2021 年	否	TO、DIP、SOP、SOT、 QFN/DFN	117.63	3.45	3.45	100%
2023 年度											
序号	客户名称	注册及 经营地区	成立时间	主营业务	合作 时间	是否存 在关联 关系	销售产品类型	销售金 额	期末应 收账款	期后回 款情况	回款 比例
1	钰太科技 股份有限公司	中国台湾	2005/12/12	感测器元件及其应 用晶片组	2022 年	否	MOD、SOT	4,503.91	225.54	225.54	100%

2	天钰科技股份有限公司	中国台湾	1995/7/4	半导体及相关设备	2019年	否	ESOP、SOP、SOT、QFN/DFN	1,121.95	298.01	298.01	100%
3	達芯股份有限公司	中国台湾	2009/2/17	电子器械、设备配线供应和建筑材料	2022年	否	SOP、TO	65.28	22.23	22.23	100%
4	香港英哲电子科技有限公司	中国香港	2017/11/3	IC 设计，芯片代理	2023年	否	ESOP、SOT、DFN	53.90	30.11	30.11	100%
5	廣閱科技股份有限公司	中国台湾	2007/11/7	电子、电器批发及工程服务	2021年	否	QFN、SOP	51.57	11.55	11.55	100%

2023年至2025年，公司境外前五大客户回款情况良好，不存在回款异常的情况。

2023年至2025年，公司境内外收入、毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2025 年	2024 年度	2023 年度
境内主营收入	70,388.38	59,729.24	46,205.45
境外主营收入	3,246.06	2,970.87	5,928.37
境外收入占主营收入比例	4.41%	4.74%	11.37%
境内毛利率	1.97%	-6.92%	-17.05%
境外毛利率	12.71%	13.59%	7.44%
主营业务毛利率	2.44%	-5.94%	-17.43%

在销售区域上，公司以境内销售为主，境外销售为辅，内外销毛利率受国内外需求竞争情况、产品销售结构以及产品生产成本等因素的影响而波动。公司境外销售规模较小，受单个客户或单笔业务的影响较大，故公司境内销售的毛利率水平与境外销售的毛利率水平差异较大。

2023年至2025年，公司境外销售产品占比如下：

单位：万元

类型	2025 年		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
SOT	918.45	28.29%	1,152.12	38.78%	3,734.21	62.99%
SOP	217.89	6.71%	140.69	4.74%	188.17	3.17%
DFN/QFN	874.67	26.95%	576.29	19.40%	343.95	5.80%
LQFP	20.32	0.63%	25.00	0.84%	-	0.00%
其他	1,198.79	36.93%	1,061.79	35.74%	1,662.04	28.04%
晶圆测试	15.94	0.49%	14.99	0.50%	-	0.00%
合计	3,246.06	100.00%	2,970.87	100.00%	5,928.37	100.00%

2025年度公司境外客户毛利率高于境内客户毛利率，主要原因在于尽管内外销产品类型基本相同，但产品结构存在差异。境外销售中DFN/QFN、SOT及其他产品的收入占比较高，境外客户更看重产品质量和性能，价格敏感性相对较低。

2025年度公司各封装形式产品境内外销售均价、平均成本情况列示如下：

单位：元/只

类型	境内销售均价	境外销售均价	境内平均成本	境外平均成本
SOT	0.0430	0.0396	0.0418	0.0462
SOP	0.0645	0.0818	0.0700	0.0925
DFN/QFN	0.0865	0.0731	0.0795	0.0560
LQFP	0.2956	0.9047	0.2724	0.6399
其他	0.0715	0.1518	0.0674	0.1032

由上表可见，境内外各封装类型产品的销售均价与平均成本均存在一定差异，具体分析如下：

SOT方面，境外销售均价低于境内，境外平均成本高于境内，主要系境外部分订单系小批量定制规格，生产成本相对较高；SOP方面，境外均价高于境内，但境外成本亦高于境内，主要原因有三：一是SOP属传统封装形式，引线框架尺寸较大、用料较多，单位材料成本本身偏高，二是SOP并非公司主力封装品类，报告期内产销规模较小（2025年境外收入217.89万元，占比仅6.71%），产线开工率不足、规模效应有限，单位固定成本分摊较高，三是境外SOP订单以多品种、小批量、非标定制规格为主，换线频繁、良率相对较低，进一步推高单位成本，故境外成本高于境内。公司维持SOP生产主要为配合客户整体封装配套需求，该产品虽毛利为负但收入占比较小，对境外整体毛利率影响有限；DFN/QFN方面，境外销售均价高于境内，主要系品种结构与批量定价共同所致：境外DFN/QFN订单集中于标准化、引脚数较少、尺寸较小的大批量规格，单价本身低于境内含较多高引脚数、大尺寸定制规格的产品，同时大批量、单一规格的连续订单使良率提升、产线利用率提高、单位固定成本下降，成本降幅大于价格降幅，故售价虽低而毛利率反而更高，是境外毛利率的重要正向贡献来源；其他类封装产品（主要为MOD、ESOP、CPC等公司特色封装产品）方面，境外销售均价为境内的2.12倍，主要系上述产品技术附加值较高，境外客户对该类特色封装产品认可度较高，公司溢价能力强，故毛利率显著高于境内同类及其他标准封装产品，且其境外收入占比最高，是拉动境外毛利率高于境内的最主要因素；LQFP境外均价远高于境内，但该产品境外收入占比较小，影响有限。

此外，境内外结算币种不同，汇率波动亦对境外产品销售均价产生影响，从

而推升境外毛利率。自2023年以来，美元指数总体呈偏强运行态势，中美货币政策分化导致利差倒挂加深。在此背景下，2023年至2025年期间，美元兑人民币汇率整体处于近年相对高位，但期间亦经历双向波动。受此汇率环境及公司美元收入结算结构影响，境外业务在报表折算及汇兑损益层面获得阶段性正向贡献，对当期境外毛利率产生了一定抬升作用。

综上，2023年至2025年，公司境外前五大客户合作背景真实，与公司不存在关联关系，销售产品与公司主营业务相匹配，期后回款情况整体良好。报告期内，公司境外销售规模较小，毛利率受客户结构、产品结构、订单定价及汇率波动影响较大；境外毛利率高于境内毛利率，主要系境外销售产品结构、客户价格敏感度、单位成本及外币结算等因素综合影响所致，具有合理性。

（五）说明晶圆贸易业务的商业背景、业务流程、定价政策、毛利率、收入确认方法及依据，以及该业务的后续规划。

1、晶圆贸易业务的商业背景

受公司核心封装测试业务存在淡旺季周期波动影响，自设立之初，基于自身产能平衡、经营稳定发展的内在需要，公司规划配套开展晶圆相关经营业务：淡季自有封装订单不足、产线产能闲置，公司外购市面通用晶圆，利用富余产能加工制成成品对外销售，充分盘活自有生产资源、摊薄固定生产成本；旺季自有封装订单饱满、产能满负荷运转，若下游客户存在晶圆采购需求，公司可将自购未投入生产的晶圆直接转售客户。同时，依托长期经营积累的成熟供应商渠道，立足完善对客户的综合配套服务、增强客户粘性、提升自身综合竞争力的发展诉求，公司配套承接少量晶圆贸易业务。

自2022年，公司出于丰富产品布局、拓展功率器件封装赛道、提升核心技术实力的长期发展战略，启动自建功率器件专用封装测试生产线。为自主打磨、验证功率器件封装全套工艺技术，突破相关工艺技术壁垒，夯实公司在功率器件领域的业务基础，公司主动采购功率器件晶圆开展封装试制与技术验证工作。在持续开展工艺试制、样品研发过程中，公司逐步与多家功率器件晶圆供应商建立长期稳定合作供货渠道，具备稳定批量采购功率器件晶圆的资源优势。为进一步

延伸服务链条、巩固客户合作关系、完善功率器件领域一站式配套服务能力，契合公司多元化综合服务商的发展定位，公司在客户有需求的时候承接少量晶圆贸易业务。

2、晶圆贸易的业务流程

(1) 自购晶圆储备

公司为满足晶圆贸易及自购芯片封装测试业务需求，长期储备约 2000 片左右的晶圆库存，当库存不足或有客户需求时，负责晶圆的业务部门经批准后采购补充。

(2) 晶圆销售业务流程

接受客户订单—核查晶圆库存—库存充足时开销售单—销售出库—月底对账开票

库存不足时—发起采购流程—采购入库—开销售单—销售出库—月底对账开票

3、定价政策

以市场价为基准，与客户合作时基本确定合作价格，固定执行，当市场价格发生变化时，双方协商进行价格变更。公司定价基本原则为 5%左右成本加成报价，具体价格与客户协商确认。

对于指定供应商的销售，先确定采购价格，成本加成 5%左右后与客户协商确认销售价格。

4、毛利率

2025 年度及 2026 年一季度晶圆贸易毛利率如下表：

期间	销售分类	收入（万元）	成本（万元）	毛利额（万元）	毛利率（%）
2025 年	净额法	85.95	-	85.95	100.00
	总额法	524.06	506.38	17.69	3.38
	合计	610.01	506.38	103.64	16.99

2026年1-3月	净额法	11.48	-	11.48	100.00
	总额法	-	-		
	合计	11.48	-	11.48	100.00

5、收入确认方法及依据

2025年公司晶圆贸易营业收入金额为610.01万元，占总营业收入的比重为0.79%，占比较低。结合业务实质，公司核算方法有净额法和总额法。

净额法核算依据：一是公司与客户签订的合同条款中列明公司向特定供应商采购晶圆，产品规格、数量、交期均由客户确定，公司无自主采购及选型权；二是产品质量问题、售后修复更换及客户投诉均由生产厂家负责，公司仅做流程配合，不承担商品交付的主要履约责任；三是交付前产品质量风险由原厂承担；交付后产品执行NCNR不退不换约定，公司在商品转让前后均不承担存货减值、滞销、退回及质量损失风险，未享有存货对应的主要风险报酬；四是交易价格由客户、供应商及公司三方协商确定，公司无法独立自主定价，无法主导商品交易价差。公司介入业务主要系因为上下游企业信用周期差异，公司可以从中灵活调剂收付款账期，获取一定的收益。综上，公司在该业务中仅为代理人角色，按照企业会计准则要求采用净额法确认收入，收入核算符合业务实质及准则规定。

总额法核算依据：一是公司与客户签订的合同条款并未指定供应商，公司可以自主选择供应商；二是货物交付前后，产品对应的各类存货风险均由公司承担，公司是向客户交付商品的责任主体；三是订单履约期间，若产品数量、价格、交期发生变动，由公司主动与客户沟通，拥有自主定价及调整交易条款的权利；四是发货前能够控制相关晶圆产品，交易中承担主要履约义务。综上，该项业务公司属于主要责任人，依据企业会计准则采用总额法确认销售收入，会计核算符合业务实际与准则要求。

6、该业务的后续规划

公司因基于平衡产能、摊薄固定成本开展自购芯片封装测试业务，开拓功率器件封装测试业务，与晶圆供应商建立了稳定的合作关系，拥有晶圆采购渠道，因而在客户有需求时，基于维护客户关系之考虑，公司少量开展了晶圆贸易业务。

公司过往未投入资源专项开展晶圆贸易业务，后续也不会投入资源专项开展晶圆贸易业务。

（六）会计师核查程序

针对上述事项，会计师执行了以下核查程序：

1、访谈企业管理层，了解与收入确认相关的关键内部控制，并测试相关内部控制的运行有效性，评价其设计和执行是否有效。

2、查询和分析同行业上市公司收入确认政策是否与公司收入确认政策存在重大差异。

3、按照《企业会计准则》中对总额法和净额法确认营业收入的标准进行分析公司自购芯片封装测试业务和晶圆贸易业务的收入确认方法是否正确。

4、分析客供芯片和自购芯片两种模式下前五大供应商和客户的交易情况、定价依据、是否具有关联关系等。

5、对自购芯片封装测试进行毛利率分析并分析在毛利率较低的情况下，公司继续从事该项业务的合理性。

6、按照不同口径进行毛利率分析，如按客户口径、按产品、按境内外等，分析毛利率波动是否合理。

7、对公司从事晶圆贸易的商业合理性进行分析，检查销售合同以及采购合同，分析判断公司是主要责任人还是代理人身份从而确定公司营业收入确认的准确性，对该业务进行毛利率分析。

8、选取样本对期末应收账款余额及本期销售额实施函证程序；对未回函的实施替代测试程序并检查其期后回款情况；对于回函不符的编制余额调节表。

9、对报告期收入按产品、按客户类型分年度、月度进行毛利率分析，分别从销售模式、产品销量、成本结转、销售价格等方面分析其变动合理性。

（七）会计师核查结论

经核查，会计师认为：

1、关于客供芯片和自购芯片业务模式、客户供应商及行业惯例，2025年度公司封装测试业务以客供芯片封装测试为主，自购芯片封装测试为补充，自购芯片业务收入占比较低。公司客供芯片和自购芯片两种模式下的主要客户、供应商与公司均不存在关联关系，相关交易定价依据合理，具有公允性。公司自购芯片封装测试业务主要平衡公司产能，除晶圆来源外，与客供芯片封装测试业务流程不存在重大差异，符合半导体行业垂直分工特点及行业惯例，具有商业合理性。

2、关于自购芯片封装测试毛利率较低及继续开展的合理性，公司自购芯片封装测试毛利率较低，主要系业务规模较小、固定成本分摊压力较大，同时受前期行业价格下行、通用型芯片售价承压及晶圆采购成本相对刚性等因素影响所致。报告期内，该业务毛利率持续改善，单位售价与单位成本倒挂幅度明显收窄。公司继续开展该业务主要系其具有产能调剂、摊薄固定成本等经营价值，且该业务收入占比较低、规模可控，不构成公司经营的主要风险来源，继续开展该业务具有商业合理性。

3、公司自购芯片封装测试业务的收入确认方法均采用总额法，收入确认依据合理，不存在客户指定晶圆供应商、约定晶圆价格或实质由客户承担晶圆价格波动的情况。

4、关于境外客户及境外毛利率高于境内的合理性，2023年至2025年，公司境外前五大客户合作背景真实，与公司不存在关联关系，销售产品与公司主营业务相匹配，期后回款情况整体良好，不存在重大异常情形。报告期内，公司境外销售规模较小，毛利率受客户结构、产品结构、订单定价及汇率波动影响较大；境外毛利率高于境内毛利率主要系境外销售产品结构、客户价格敏感度、单位成本及外币结算等因素综合影响所致，具有合理性。

5、公司晶圆贸易业务具有商业合理性、业务流程清晰、收入确认方法准确、毛利率变动原因合理以及公司对于该业务的后续规划清晰。

三、关于负债及担保

年报显示，（1）2025年末，公司流动负债 100,368.78 万元，较上年末增加 8.65%，包括短期借款 14,650.46 万元，应付票据及应付账款 52,867.69 万元，其他应付款 18,253.70 万元，一年内到期的非流动负债 8,116.06 万元；流动资产

46,195.25 万元，较上年末增加 13.01%，其中货币资金 6,462.38 万元，应收票据、应收账款及其他应收款合计 23,704.48 万元。（2）2025 年度公司对子公司担保发生额 11,557.73 万元，期末对子公司担保余额 63,319.03 万元，担保余额占公司净资产的 108.78%。

请公司：（1）列示 2026 年各月短期借款、应付票据及应付账款、一年内到期非流动负债、其他应付款等到期时间节点及金额，测算现有可用货币资金及经营性现金流能否覆盖前述到期的债务本息；（2）结合 2025 年末应付票据、应付账款、其他应付款的构成及账龄，说明上述款项是否存在逾期支付、违约或诉讼情形；对于账龄超过 1 年的重要应付账款，逐笔说明形成原因、结算条件、是否为上市公司关联方等；针对其他应付款中涉及公司实控人及多位关联个人的情况，说明相关其他应付款的形成原因、挂账时间等；（3）结合 2025 年末应收票据、应收账款、其他应收款的期后回款情况，说明公司采取的流动性管理措施（如加速回款、应收账款保理、票据贴现等），相关措施的具体金额及现金流改善效果；（4）结合公司资产及负债结构，说明是否存在短债长用、期限错配问题，并结合 2025 年筹资活动现金流量净额较 2024 年大幅下降的事实，说明公司外部融资能力是否存在恶化，并提示相关风险；（5）全面梳理公司及子公司对外担保情况，列示被担保对象的名称、注册资本、股权结构、主营业务、主要财务数据、担保额度及余额、担保期限、借款金额等，说明相关担保的背景及必要性；（6）针对被担保对象中非全资子公司的，说明是否设置反担保等保护条款或措施，并量化评估公司因承担担保责任而可能面临的代偿风险。

回复：

（一）列示 2026 年各月短期借款、应付票据及应付账款、一年内到期非流动负债、其他应付款等到期时间节点及金额，测算现有可用货币资金及经营性现金流能否覆盖前述到期的债务本息

2025 年末短期借款、应付票据及应付账款、一年内到期非流动负债、其他应付款在 2026 年各月需偿还情况如下表所示：

单位：万元

科目	2025年 期末余额	2026年1 月份到期	2026年2 月份到期	2026年 3月份到 期	2026年4 月份到期	2026年 5月份 到期	合计	截止 2026年5 月31日 已付款金 额
短期借款	14,650.46	1,464.77	1,162.30	1,500.35	1,331.51	161.53	5,620.46	5,620.46
应付票据	9,590.00	880.00	1,900.00	1,550.00	2,980.00	1,190.00	8,500.00	8,500.00
应付账款	43,277.69	19,383.68	4,433.38	1,781.60	1,377.01	972.24	27,947.91	25,001.03
一年内到期 非流动负债	8,116.06	1,130.00	348.28	982.83	1,050.53	243.84	3,755.48	3,755.48
其他应付款	18,253.70	247.20	14,399.33	134.33	63.85	60.76	14,905.47	14,905.47

如上表所示，截止 2026 年 5 月 31 日，公司需要偿还的到期流动负债为 2,946.88 万元，其中，短期借款、应付票据、一年内到期非流动负债、其他应付款均在到期日偿还，无逾期支付的情况。应付账款存在到期未支付金额 2,946.88 万元，但公司已与供应商进行友好协商每月都会陆续付款，不存在供应商断供及经济纠纷，不会对生产经营产生影响。

截止 2026 年 5 月 31 日，公司账面货币资金余额为 10,177.23 万元，足以覆盖到期未支付的流动负债。

(二) 结合 2025 年末应付票据、应付账款、其他应付款的构成及账龄，说明上述款项是否存在逾期支付、违约或诉讼情形；对于账龄超过 1 年的重要应付账款，逐笔说明形成原因、结算条件、是否为上市公司关联方等；针对其他应付款中涉及公司实控人及多位关联个人的情况，说明相关其他应付款的形成原因、挂账时间等

1、2025 年末应付票据、应付账款、其他应付款的构成及账龄如下所示：

(1) 应付票据

截止 2025 年 12 月 31 日，公司应付票据余额 9,590.00 万元，主要是材料款和外协加工费，账龄均为 1 年内，不存在逾期支付、违约或诉讼情形。

(2) 应付账款

截止 2025 年 12 月 31 日，公司应付账款余额 43,277.69 万元，主要是材料款、设备款和工程款。

单位：万元

项目	期末余额	1年以内	1年至2年	2年至3年	3年以上
材料款	22,363.00	22,241.02	98.90	14.76	8.32
工程设备款	20,423.57	14,245.48	6,039.71	90.62	47.77
其他	491.12	442.65	43.52	0.93	4.01
合计	43,277.69	36,929.15	6,182.13	106.31	60.10

报告期内，公司工程设备款账龄较长，存在部分逾期未支付的工程设备款，公司已与供应商协商，每月都会有陆续付款，不存在供应商断供及经济纠纷，不会对生产经营产生影响；其他款项不存在逾期支付、违约或诉讼情形。

设备款截止至 2025 年 12 月 31 日逾期未支付明细如下：

单位：万元

供应商名称	逾期金额
先域微电子技术服务（上海）有限公司	2,733.87
产投三佳（安徽）科技股份有限公司及其关联方	279.07
江苏京创先先进电子科技有限公司	264.6
深圳市曜通科技有限公司	22.6
INTIMAX Inc.	16.31
合计	3,316.45

上述款项，公司已与供应商进行友好协商每月都会陆续付款，不存在供应商断供及经济纠纷，不会对生产经营产生影响。

公司与主要供应商均保持了良好的合作关系，相关供应商与公司的经营业务正常开展，不存在因款项支付时间而影响公司正常生产经营的情形。

（3）其他应付款

截止 2025 年 12 月 31 日，公司其他应付款余额 18,253.70 万元，主要包含限制性股票回购义务、押金、保证金、借款、其他等；具体明细如下表所示：

单位：万元

科目	金额合计	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
其他应付款	18,253.70	15,979.94	50.85	1,960.62	262.29
其中：限制性股票回购义务	2,008.45	352.18	-	1,656.27	-
押金	532.32	165.45	43.44	64.01	259.42
保证金	847.70	610.00	-	237.70	-
借款	14,396.51	14,396.51	-	-	-
其他	468.72	455.81	7.41	2.63	2.88

上述借款主要系实控人借款，公司在 2026 年 2 月已向实控人偿还，限制性股票回购义务存在账龄较长的款项主要系限制性股票尚未解锁所致，模具押金和产能保证金存在长账龄款项主要系按照合同约定尚未达到付款条件所致；上述款项均按照付款节点进行支付，不存在逾期支付、违约或诉讼情形。

2、账龄超过 1 年的重要应付账款情况如下：

单位：万元

供应商名称	金额	形成原因	结算条件	是否为上市公司关联方
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	2,080.70	工程款尚未结算	工程竣工验收后付款，尚未达到付款条件	否
先域微电子技术服务（上海）有限公司	1,949.60	设备款尚未结算	按照合同约定的进度付款，设备验收后且收到开具的全额增值税专用发票后开始付款。	否
产投三佳（安徽）科技股份有限公司及其关联方	457.27	设备款尚未结算	根据双方结算协议，每月支付约定额度的货款，当月到期货款大于该	否

供应商名称	金额	形成原因	结算条件	是否为上市公司关联方
			额度时，至多支付该额度，超过部分顺延至下个月；当月到期贷款少于约定额度时，按到期具体金额支付。	
上海鹏武电子科技有限公司	326.65	设备款尚未结算	根据合同约定，合同签订后一定时间内支付部分预付款，设备验收一定时间后按月分期支付。	否
江苏京创先进电子科技有限公司	262.91	设备款尚未结算	验收合格且收到乙方提供的全额增值税专用发票后，按月分期支付。	否
马丁科瑞半导体（浙江）有限公司	248.85	设备款尚未结算	设备试用一定时间，在合同签订后支付部分预付款，乙方应向甲方开具全额增值税发票，设备验收合格后按月分期支付。	否
深圳市曜通科技有限公司	127.71	设备款尚未结算	设备验收合格且收到全额增值税专用发票后按月支付。	否
INTIMAX Inc.	114.64	设备款尚未结算	设备到货且安装调试完成起算试运行一定时间，试用期满后经验收合格后按月分期支付。	否
合计	5,568.34			

如上表所示，对于账龄超过 1 年的重要应付账款，均具有商业实质并均未实际逾期。

3、其他应付款中涉及公司实控人及多位关联个人的明细及情况如下表所示：

单位：万元

名称	金额	形成原因	挂账时间
梁大钟	14,366.51	借款及利息	1 年以内
白瑛	3.48	报销款	1 年以内
梁大钟	7.56	报销款	1 年以内
文正国	1.10	报销款	1 年以内

名称	金额	形成原因	挂账时间
王羊宝	0.31	报销款	1年以内
李泽伟	0.70	安全生产保证金	2年至3年, 3年以上
饶锡林	0.70	安全生产保证金	2年至3年, 3年以上
宋晓莉	0.25	安全生产保证金	2年至3年, 3年以上
孙少林	0.10	安全生产保证金	3年以上

其他应付款中涉及的实控人部分主要系实控人借款给公司,用于公司日常的生产经营,对于实控人的借款,公司在2026年2月已向实控人偿还;其他关联个人主要系管理层缴纳的安全生产保证金及日常报销款。

(三) 结合2025年末应收票据、应收账款、其他应收款的期后回款情况,说明公司采取的流动性管理措施(如加速回款、应收账款保理、票据贴现等),相关措施的具体金额及现金流改善效果

2025年末应收票据、应收账款、其他应收款的期后回款情况如下表所示:

单位: 万元、%

科目	期末余额	2026年1月份回款	2026年2月份回款	2026年3月份回款	2026年4月份回款	2026年5月份回款	合计	回款比例
应收票据	6,678.59	828.29	1,646.51	2,697.35	547.60	715.06	6,434.81	96.35
应收账款	16,697.40	8,064.52	4,548.10	1,279.00	1,001.12	412.37	15,305.11	91.66
其他应收款	1,860.22	146.78	43.29	6.95	232.61	49.21	478.84	25.74

2025年末应收票据、应收账款、其他应收款截止2026年5月31日回款比例分别为96.35%、91.66%、25.74%,其他应收款回款比例较低主要系保证金未到约定收回时间所致。

如上表所示，报告期后应收账款和应收票据的回款较快，主要系企业对应收账款的催收，期后回款金额 15,305.11 万元，回款率 91.66%。因公司应收账款回款较快且回款情况良好，尚未考虑通过应收账款保理的方式获取流动资金。通过上述措施，应收票据、应收账款、其他应收款期后回款分别为 6,434.81 万元、15,305.11 万元、478.84 万元，回款比例分别为 96.35%、91.66%、25.74%。通过实施上述措施，2026 年 5 月 31 日公司货币资金为 10,177.23 万元，较 2025 年 12 月 31 日 6,462.38 万元，增加 3,714.85 万元，增加比例 57.48%。

2025 年末其他应收款中应收泰兴市龙腾电子有限公司押金 688.91 万元，截止 2026 年 5 月 31 日，尚未收回 570.31 万元，主要原因系尚未达到返还条件，公司与泰兴市龙腾电子有限公司相关合同约定如下：

单位：万元

引线框规格	未返还押金	截止 2026-5-31 返还金额	返还条件	备注
引线框架模具 TSSOP811R (80*80) : 1 套	66.50	-	产品累计采购金额达到后返还	尚未达到返还条件
引线框架模具 LQFP64/铜/210*210/2: 1 套	40.80	-	产品累计采购金额达到后返还	尚未达到返还条件
引线框架模具 SOT23-6(24R)铜/35*72: 1 套	32.00	-	产品累计采购金额达到后返还	尚未达到返还条件
SOP8 (15R)/CU/02, SOP8 (15R)/CU/01, SOP815R)/CU/81*109-81*109, SOP8 (15R)/CU/90*90/, SOP7 (15R)/CU/01, SOP8 (15R)/CU/95*130/, ESOP8 (15R)/CU/01	185.90	112.00	在两年内采购量达到一定数量	剩余押金尚未返还
电镀模具 TO263-3/Cu/01、TO220-3/Cu/01	2.40	-	产品累计采购金额达到后返还	尚未达到返还条件
冲压模具 TO252-3A(8R)/Cu/01、02、04、05: 1 套, 电镀模具 TO252-3A(8R)/Cu/01: 1 套, 电镀模具 TO252-3A(8R)/Cu/05: 1 套	31.50	-	3 年内产品累计采购金额达到后返还	尚未达到返还条件

引线框规格	未返还押金	截止2026-5-31 返还金额	返还条件	备注
冲压模具 SOT89-3A(18R)/Cu/01、02、SOT89-3B(18R)/Cu/01: 1副、成型模具 SOT89-3A(18R)/Cu/01、02、SOT89-3B(18R)/Cu/01: 1副、电镀模具 SOT89-3A、3B(18R)/Cu/01: 1副、电镀模具 SOT89-3A(18R)/Cu/02: 1副。	42.50	-	量产后3年内采购金额达到后返还	尚未达到返还条件
电镀模具 SOP8(15R)/Cu/08: 1套、电镀模具 SOP8(15R)/Cu/09:1套	5.60	-	3年内达到采购金额达到后返还	尚未达到返还条件
冲压模具 TO220AB-3/Cu/01、TO263AB-3/Cu/01: 1套; 成型切断模具 TO220AB-3/Cu/01、TO263AB-3/Cu/01: 1套	6.60	6.60	量产后2年内采购金额达到后返还	截止 2026.5.31 已全部返还
TSSOP8 (11R)94*130 (共用6款模具); TSSOP8 (11R)-CU-01(59*130) (共用2款模具); TSSOP8 (11R)80*80-A (共用2款模具)	60.61	-	三年内达到一定采购量后	尚未达到返还条件
ESOP8B/Cu/02	5.20	-	量产3年内采购量达到后返还	尚未达到返还条件
TOLL-8(6R)/Cu/01、TOLL-8(6R)/Cu/02、TOLL-8(6R)/Cu/03、TOLL-8(6R)/Cu/04: 1套	29.00	-	3年内采购量达到后返还	尚未达到返还条件
ESOP8C/Cu/01 冲压模具+成型模具+电镀模具共3套	22.90	-	3年内采购金额达到后返还	尚未达到返还条件
SOP8(15R)/CU/11 蚀刻模具1套	1.20	-	2年内采购金额达到后返还	尚未达到返还条件
TO252-5/CU/02	2.80	-	2年内采购金额达到后返还	尚未达到返还条件
引线框架模具 SOP815R (60*60): 1套	49.00	-	累计采购金额达到后返还	尚未达到返还
引线框架模具 SOP8/Cu/109*169/7: 1套	3.60	-	累计采购金额达到后返还	尚未达到返还条件
引线框架模具 TO220-3/铜/320*217/3 (与TO263-3/铜/320*217/3 共用冲压模、成型模): 1套	15.00	-	累计采购金额达到后返还	尚未达到返还条件
引线框架模具 1.27PDFN5*6: 1套	33.30	-	累计采购金额达到后返还	尚未达到返还条件
引线框架模具 0.65PDFN33*33: 1套	49.00	-	累计采购金额达到后返还	尚未达到返还条件

引线框规格	未返还押金	截止2026-5-31 返还金额	返还条件	备注
冲压模具 TO220-3/Cu/03、TO263-3/Cu/05：1套	3.50	-	3年内累计采购金额达到后返还	尚未达到返还条件
合计	688.91	118.60		

（四）结合公司资产及负债结构，说明是否存在短债长用、期限错配问题，并结合 2025 年筹资活动现金流量净额较 2024 年大幅下降的事实，说明公司外部融资能力是否存在恶化，并提示相关风险

1、公司不存在短债长用、期限错配的情况

2025 年末，公司短期借款余额为 14,650.46 万元，较 2024 年末减少 4,354.22 万元，短期借款减少主要公司经营情况逐步好转，经营性现金流量情况逐步改善，同时公司为满足行业需求增长持续投入扩充产能，逐步增加期限更为匹配的长期借款规模，综合导致短期借款规模下降；公司其他应付款余额为 18,253.70 万元，较 2024 年末增加 10,544.02 万元，主要系为满足公司经营资金周转需求，公司向实际控制人梁大钟借款，相关资金用于支付采购款、偿还银行借款等经营活动。

截至 2025 年年末，公司借款情况如下表：

序号	借款对象	金融机构	金额	利率	期限	到期日	用途	类型
			(万元)		(年)			
1	广东气派	中信银行股份有限公司东莞分行	700.00	3.85%	1.00	2026/1/23	补充流动资金	短期借款
2	广东气派	中信银行股份有限公司东莞分行	300.00	3.85%	1.00	2026/1/26	补充流动资金	短期借款
3	广东气派	中信银行股份有限公司东莞分行	300.00	3.85%	1.00	2026/2/6	补充流动资金	短期借款
4	广东气派	中信银行股份有限公司东莞分行	990.00	3.85%	1.00	2026/4/8	补充流动资金	短期借款
5	广东气派	中国银行东莞石排支行	1,200.00	3.00%	1.00	2026/6/11	补充流动资金	短期借款
6	广东气派	中国银行东莞石排支行	1,000.00	3.00%	1.00	2026/7/11	补充流动资金	短期借款

7	广东气派	广州银行东莞分行营业部	1,875.00	3.60%	7.00	2029/10/10	设备购置贷款	长期借款
8	广东气派	广州银行东莞分行营业部	2,625.00	3.60%	7.00	2029/10/10	设备购置贷款	长期借款
9	广东气派	广州银行东莞分行营业部	3,000.00	3.50%	7.00	2029/10/10	设备购置贷款	长期借款
10	广东气派	中国银行东莞石排支行	166.08	3.30%	10.00	2033/1/11	二期厂房建设贷款	长期借款
11	广东气派	中国银行东莞石排支行	334.08	3.30%	10.00	2033/1/11	二期厂房建设贷款	长期借款
12	广东气派	中国银行东莞石排支行	336.86	3.30%	10.00	2033/1/11	二期厂房建设贷款	长期借款
13	广东气派	中国银行东莞石排支行	440.64	3.30%	10.00	2033/1/11	二期厂房建设贷款	长期借款
14	广东气派	中国银行东莞石排支行	458.19	3.30%	10.00	2033/1/11	二期厂房建设贷款	长期借款
15	广东气派	中国银行东莞石排支行	604.24	3.30%	10.00	2033/1/11	二期厂房建设贷款	长期借款
16	广东气派	中国银行东莞石排支行	643.20	3.30%	10.00	2033/1/11	二期厂房建设贷款	长期借款
17	广东气派	中国银行东莞石排支行	706.56	3.30%	10.00	2033/1/11	二期厂房建设贷款	长期借款
18	广东气派	中国银行东莞石排支行	713.28	3.30%	10.00	2033/1/11	二期厂房建设贷款	长期借款
19	广东气派	中国银行东莞石排支行	852.64	3.30%	10.00	2033/1/11	二期厂房建设贷款	长期借款
20	广东气派	中国银行东莞石排支行	1,098.24	3.30%	10.00	2033/1/11	二期厂房建设贷款	长期借款
21	广东气派	中国银行东莞石排支行	1,144.32	3.30%	10.00	2033/1/11	二期厂房建设贷款	长期借款
22	广东气派	中国银行东莞石排支行	1,152.00	3.30%	10.00	2033/1/11	二期厂房建设贷款	长期借款
23	广东气派	中国银行东莞石排支行	1,186.04	3.30%	10.00	2033/1/11	二期厂房建设贷款	长期借款
24	广东气派	中国银行东莞石排支行	1,693.18	3.30%	10.00	2033/1/11	二期厂房建设贷款	长期借款
25	广东气派	中国银行东莞石排支行	1,807.68	3.30%	10.00	2033/1/11	二期厂房建设贷款	长期借款
26	广东气派	中国银行东莞石排支行	4,800.00	3.30%	10.00	2033/1/11	二期厂房建设贷款	长期借款
27	广东气派	平安国际融资租赁有限公司	606.69	4.50%	2.00	2026/8/30	设备购置贷款	长期应付款

28	广东气派	日盛国际融资租赁有限公司	178.63	4.54%	2.00	2026/4/25	设备购置贷款	长期应付款
29	广东气派	深圳市中小担融资租赁有限公司	2,064.08	6.00%	3.00	2027/12/20	设备购置贷款	长期应付款
30	广东气派	中关村科技租赁股份有限公司	509.09	6.63%	2.00	2026/9/29	设备购置贷款	长期应付款
31	广东气派	中关村科技租赁股份有限公司	2,297.14	5.02%	2.00	2027/3/28	设备购置贷款	长期应付款
32	广东气派	仲信国际融资租赁有限公司	434.81	6.28%	2.00	2026/12/6	设备购置贷款	长期应付款
33	广东气派	梁大钟	320.00	3.05%	1.00	2026/1/14	补充流动资金	其他应付款
34	广东气派	梁大钟	60.00	3.05%	1.00	2026/1/2	补充流动资金	其他应付款
35	广东气派	梁大钟	60.00	3.05%	1.00	2026/1/3	补充流动资金	其他应付款
36	广东气派	梁大钟	60.00	3.05%	1.00	2026/1/4	补充流动资金	其他应付款
37	广东气派	梁大钟	60.00	3.05%	1.00	2026/1/5	补充流动资金	其他应付款
38	广东气派	梁大钟	400.00	3.05%	1.00	2026/2/11	补充流动资金	其他应付款
38	广东气派	梁大钟	200.00	3.05%	1.00	2026/2/19	补充流动资金	其他应付款
40	广东气派	梁大钟	800.00	3.05%	1.00	2026/2/24	补充流动资金	其他应付款
41	广东气派	梁大钟	600.00	3.05%	1.00	2026/2/27	补充流动资金	其他应付款
42	广东气派	梁大钟	1,200.00	3.05%	1.00	2026/3/2	补充流动资金	其他应付款
43	广东气派	梁大钟	1,350.00	3.05%	1.00	2026/3/3	补充流动资金	其他应付款
44	广东气派	梁大钟	500.00	3.05%	1.00	2026/3/13	补充流动资金	其他应付款
45	广东气派	梁大钟	1,000.00	3.05%	1.00	2026/3/14	补充流动资金	其他应付款
46	广东气派	梁大钟	1,000.00	3.05%	1.00	2026/5/15	补充流动资金	其他应付款
47	广东气派	梁大钟	1,200.00	3.05%	1.00	2026/5/16	补充流动资金	其他应付款
48	广东气派	梁大钟	700.00	3.05%	1.00	2026/5/19	补充流动资金	其他应付款

49	广东气派	梁大钟	1,000.00	3.05%	1.00	2026/6/12	补充流动资金	其他应付款
50	广东气派	梁大钟	500.00	3.05%	1.00	2026/6/16	补充流动资金	其他应付款
51	广东气派	梁大钟	390.00	3.05%	1.00	2026/7/22	补充流动资金	其他应付款
52	广东气派	梁大钟	100.00	3.05%	1.00	2026/9/11	补充流动资金	其他应付款
53	广东气派	梁大钟	800.00	3.05%	1.00	2026/9/12	补充流动资金	其他应付款
54	广东气派	梁大钟	160.00	3.05%	1.00	2026/9/28	补充流动资金	其他应付款
55	广东气派	梁大钟	1,870.00	3.05%	1.00	2026/10/13	补充流动资金	其他应付款
56	气派股份	深圳农村商业银行	1,980.00	3.45%	1.00	2026/11/6	补充流动资金	短期借款
57	气派股份	中国工商银行深圳横岗支行	3,000.00	2.80%	1.00	2026/12/11	补充流动资金	短期借款
58	气派股份	上海浦东发展银行深圳分行	1,000.00	3.00%	1.00	2026/12/15	补充流动资金	短期借款
59	气派股份	上海浦东发展银行深圳分行	1,000.00	3.00%	1.00	2026/12/31	补充流动资金	短期借款
60	气派股份	深圳农村商业银行	3,820.00	3.40%	3.00	2028/3/26	补充流动资金	长期借款
61	气派股份	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	1,980.00	3.00%	3.00	2028/9/11	补充流动资金	长期借款
合计			63,327.66	-	-	-	-	-

由上表，截至 2025 年年末，公司借款金额合计 63,327.66 万元，其中公司向实际控制人梁大钟的借款 14,366.51 万元（包含利息）已于 2026 年 2 月全部还清，整体的借款规模下降。

同时，公司向金融机构借款主要用于二期厂房建设和设备购置款，借款金额合计为 31,727.66 万元。截至本回复出具日，公司前述借款中到期借款已如期偿还，公司与金融机构的信贷业务正常开展。

2、公司外部融资能力不存在恶化的情形，公司已提示相关风险

2024 年至 2026 年 1-3 月，公司筹资活动现金流量情况具体如下：

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度
吸收投资收到的现金	15,604.34	1,175.00	3,000.00
取得借款收到的现金	15,523.15	23,047.37	30,468.60
收到其他与筹资活动有关的现金	3,943.40	15,252.17	13,045.00
筹资活动现金流入小计	35,070.89	39,474.54	46,513.60
偿还债务支付的现金	16,437.06	23,113.66	21,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	504.18	1,471.87	1,494.17
支付其他与筹资活动有关的现金	16,476.93	12,705.81	2,695.67
筹资活动现金流出小计	33,418.18	37,291.33	25,889.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,652.71	2,183.21	20,623.76

2024年至2026年1-3月，公司筹资活动现金流入金额分别为46,513.60万元、39,474.54万元、35,070.89万元，筹资活动现金流出金额分别为25,889.84万元、37,291.33万元、33,418.18万元，公司2025年筹资活动产生的现金流量净额较2024年大幅下滑，主要系公司自身经营情况好转，营业收入逐年增长，公司2025年经营活动产生的现金流量净额较2024年增加9,309.40万元，经营性现金流情况逐步好转，降低了公司对外部融资的需求；同时公司2025年偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金流出增加，综合导致公司2025年筹资活动产生的现金流量净额较2024年大幅下降。公司外部融资能力不存在恶化的情况。

公司已在2025年年度报告中就公司有息负债情况提示如下：

“截至2025年12月31日，公司有息负债余额63,327.66万元，其中短期借款金额为11,470.00万元，一年以内到期的长期借款金额为3,191.44万元，一年以内到期的长期应付款金额为4,767.36万元，其他应付款-个人借款金额为14,330.00万元，公司有息负债余额较大。若未来银行信贷政策收紧或公司经营活动现金流得不到改善，可能造成公司流动资金紧张，公司有息负债偿付存在一定压力，对公司经营带来不利影响。”

综上，公司不存在短债长用、期限错配的情况。公司外部融资能力不存在恶化的情形，公司已在2025年年度报告中提示了相关风险。

(五) 全面梳理公司及子公司对外担保情况，列示被担保对象的名称、注册资本、股权结构、主营业务、主要财务数据、担保额度及余额、担保期限、借款金额等，说明相关担保的背景及必要性

公司及子公司不存在对其他主体的对外担保情况。

截至 2025 年年末，公司及子公司担保情况如下：

被担保方	债权人	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	担保方式	授信金额 (万元)
气派科技	中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行	20,000.00	2020/12/21	2035/3/31	广东气派、梁大钟、白瑛担保，厂房抵押担保	16,000.00
	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	1,000.00	2025/12/15	2026/12/15	广东气派、梁大钟、白瑛担保	1,000.00
	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	1,000.00	2025/12/31	2026/12/31	广东气派、梁大钟、白瑛担保	1,000.00
	深圳农村商业银行股份有限公司南山支行	2,000.00	2025/11/6	2026/11/6	广东气派、梁大钟、白瑛担保	2,000.00
	深圳农村商业银行股份有限公司南山支行	4,000.00	2025/3/26	2028/3/26	广东气派、梁大钟、白瑛担保	4,000.00
	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	3,000.00	2025/9/5	2028/9/5	广东气派、梁大钟、白瑛担保	3,000.00
广东气派	中国银行股份有限公司东莞分行	29,700.00	2022/10/31	2034/12/31	气派股份、梁大钟、白瑛担保，厂房二次抵押担保	29,700.00
	中信银行股份有限公司东莞分行	10,000.00	2025/1/17	2028/1/17	气派股份、梁大钟、白瑛担保	10,000.00
	广州银行股份有限公司东莞分行	10,000.00	2022/10/8	2029/10/10	气派股份、梁大钟、白瑛担保	10,000.00
	平安国际融资租赁有限公司	2,299.00	2024/8/30	2026/8/30	气派股份、梁大钟、白瑛担保，设备抵押	2,200.00
	中关村科技租赁股份有限公司	4,298.61	2024/9/26	2026/9/25	气派股份、梁大钟、白瑛担保，设备抵押	4,000.00
	中关村科技租赁股份有限公司	1,557.55	2025/9/30	2027/3/30	气派股份、梁大钟、白瑛担保，设备抵押	1,500.00
	深圳市中小担融资租赁有限公司	3,310.09	2024/12/20	2027/12/20	气派股份、梁大钟、白瑛担保，设备抵押	3,000.00

日盛国际融资租赁有限公司	1,090.80	2024/4/30	2026/4/25	气派股份、梁大钟、白璞担保，设备抵押	1,000.00
仲信国际融资租赁有限公司	1,062.80	2024/12/6	2026/12/5	气派股份、梁大钟、白璞担保，设备抵押	1,000.00
宁波银行股份有限公司深圳分行	10,000.00	2022/9/1	2027/9/1	气派股份、梁大钟、白璞担保	10,000.00

由上表，公司及子公司不存在对其他主体的对外担保情况，公司不存在对非全资子公司提供担保的情形。

公司于 2025 年 4 月 26 日披露了《2025 年公司级控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的公告》，说明了担保事项履行的内部决策程序，被担保子公司情况、担保协议的主要内容等，并在 2025 年年度报告中披露了公司对外担保情况，公司 2025 年度不存在对非子公司的担保，完整地披露了对子公司的担保情况，严格履行了信息披露义务，相关披露内容真实、准确、完整。

(六) 针对被担保对象中非全资子公司的，说明是否设置反担保等保护条款或措施，并量化评估公司因承担担保责任而可能面临的代偿风险

2025 年度，公司不存在对非全资子公司提供担保的情形。

(七) 会计师核查程序

针对上述事项，会计师执行了以下核查程序：

1、获取并检查公司与银行签订的借款合同、担保合同及抵押合同，核实主债务金额、担保方式、担保范围及担保期限；

2、取得公司期末短期借款台账、应付票据台账、应付账款明细、其他应付款明细，统计 2026 年各月分别应当偿还的负债金额；以及应付账款、其他应付款款型性质及其账龄；

3、对于账龄超过 1 年的重要应付账款，分析其形成的原因、结算条件、是否为公司关联方，判断是否存在逾期未支付的重要应付账款；

4、访谈公司管理层，了解其他应付款中涉及公司实控人及多位关联个人具体原因及挂账时间；

5、取得公司期末应收票据、应收账款、其他应收款，统计 2026 年应收票据、应收账款、其他应收款期后回款情况；

6、对公司所有银行账户实施函证程序，函证内容包括资金余额、受限使用金额、保证金及担保等信息；并选取重要银行账户使用双向流水核对工具以及人工辅助的方式进行账账核对检验是否存在关联方资金占用。

（八）会计师核查结论

经核查，会计师认为：

1、公司短期借款、应付票据、其他应付款均按时支付，应付账款存在到期未支付金额 2,946.88 万元，但公司已与供应商沟通每月都会陆续付款，不存在供应商断供及经济纠纷，不会对生产经营产生影响；经测算公司现有可用货币资金及经营性现金流能覆盖前述到期的债务本息；

2、对于账龄超过 1 年的重要应付账款形成的原因一般分为工程款和设备往来款未结算，均按照合同进行结算，均不是公司的关联方；其他应付款主要包含限制性股票回购义务、押金、保证金、借款、其他等，挂账时间为 1 年以内、1-2 年、2-3 年和 3 年以上。

3、公司 2025 年末应收票据、应收账款、其他应收款截止 2026 年 5 月 31 日回款比例分别为 96.35%、91.66%、25.74%，其他应收款回款比例较低主要系保证金未到约定收回时间所致。公司应收账款回款较快，不存在应收账款保理的情况。

4、公司不存在短债长用、期限错配的情况。公司外部融资能力不存在恶化的情形，公司已在 2025 年年度报告中提示了相关风险。

5、公司及子公司不存在对其他主体的对外担保情况。

6、2025 年度，公司不存在对非全资子公司提供担保的情形。

四、关于固定资产

年报显示，（1）2025 年末公司固定资产账面价值 129,341.99 万元，占总资产的 64.30%，其中主要为机器设备，且较 2021 年上市以来总体呈现增长趋势；营业收入在 2021 年度的 80,936.37 万元之后持续处于低位，2025 年度 76,878.86 万元仍低于上市当年。（2）2025 年，公司 4,486.01 万元固定资产转入投资性房地产，投资性房地产期末余额 5,803.41 万元，较期初增加 222.77%，年报解释称主要系二期厂房增加出租所致。

请公司：（1）结合行业周期、产能利用率、产销率，以及近年来新增固定资产运营情况等，说明公司固定资产增加但营业收入下降的合理性，固定资产是否与公司生产经营实际需求相匹配；（2）结合主要产品的下游需求、产能利用率、价格及毛利率变化，说明公司主要固定资产的减值准备是否充分计提，报告期末仅计提 15.92 万元减值准备的合理性；（3）针对 2025 年末公司受限固定资产 50,575.86 万元的情况，列示受限固定资产的明细，包括固定资产类型（房屋及建筑物/机器设备/通用设备等）、标识（如房屋位置、设备型号等）、用途、账面金额、抵押比例、抵押作价、抵押背景等，并说明是否存在因公司无法履约导致抵押资产使用受限，对公司生产经营造成重大影响的风险；（4）列示报告期内由固定资产转入投资性房地产的具体资产明细，包括资产名称、坐落位置、建筑面积、资产原值、累计折旧、减值准备、转换日账面价值、转换日及确定依据，对照《企业会计准则》有关投资性房地产的确认条件，说明公司转换条件、转换时点的判断依据是否充分；（5）量化分析上述固定资产转为投资性房地产对公司 2025 年财务报表的具体影响，如折旧/摊销金额、营业成本及管理费用、全年净利润等的影响金额；（6）结合公司 2025 年产能利用率上半年较低、下半年有所恢复的经营背景，说明公司将二期厂房转为出租而非自用的具体原因及商业合理性。

回复：

（一）结合行业周期、产能利用率、产销率，以及近年来新增固定资产运营情况等，说明公司固定资产增加但营业收入下降的合理性，固定资产是否与公司生产经营实际需求相匹配

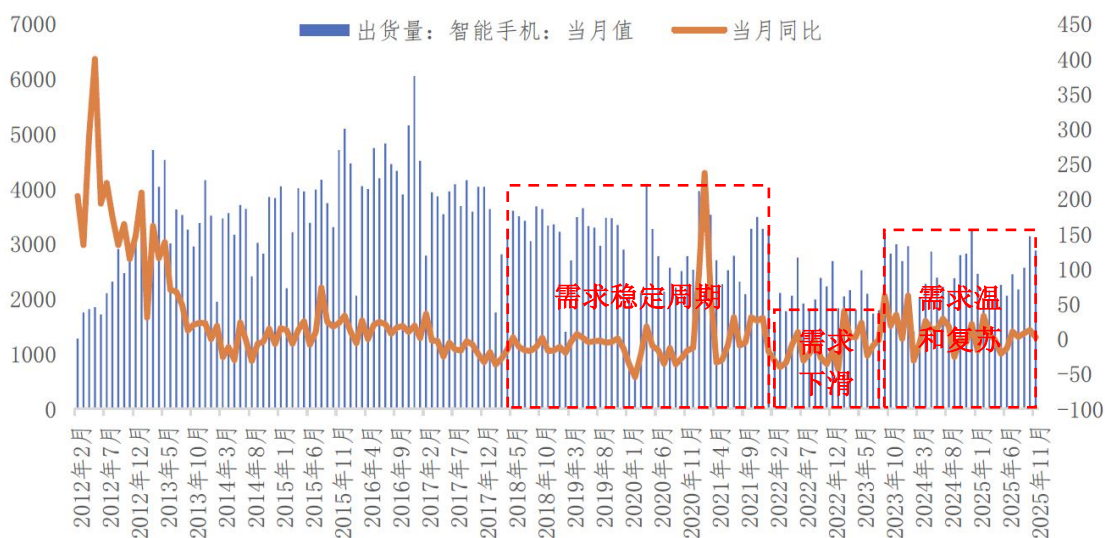
1、行业周期

以公司产品终端应用市场智能手机为例，全球智能手机和中国智能手机出货量情况如下：

全球智能手机出货量及当季同比（单位：百万台）

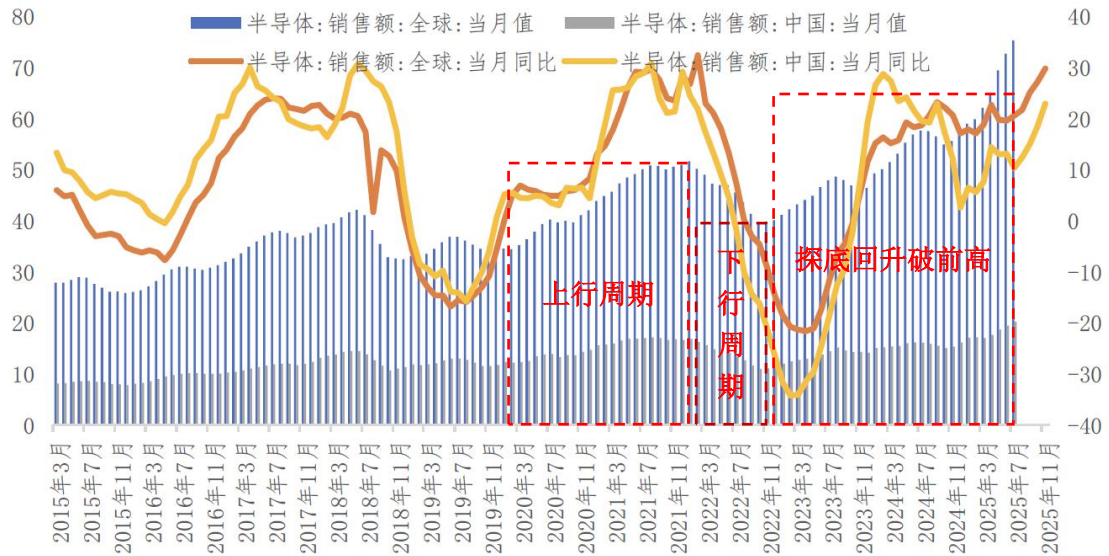


中国智能手机出货量及当月同比（单位：百万台）



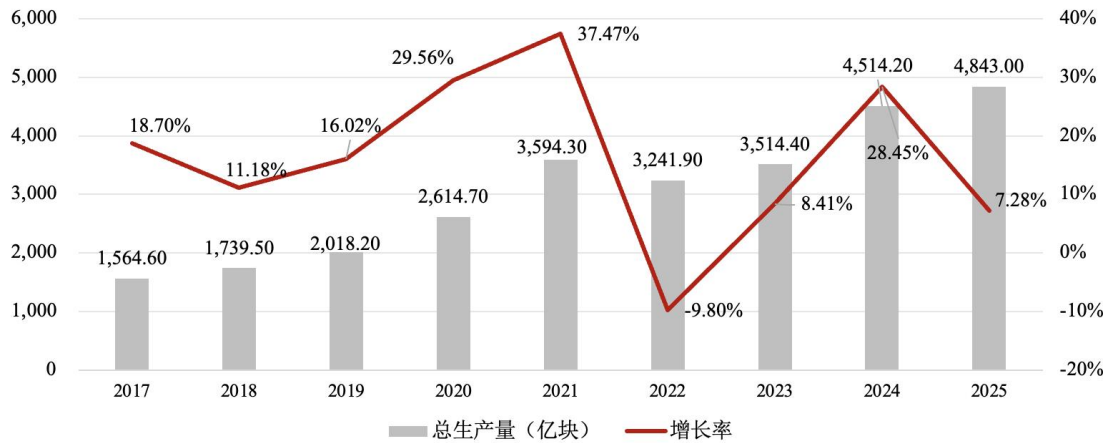
由上图数据，全球和中国智能手机出货量在 2021 年第四季度达到出货高峰后，自 2022 年一季度开始出货量大幅下降，在 2023 年下半年出货量开始缓慢回升。

全球半导体销售额及当月同比（单位：十亿美元）



由上图数据，全球半导体销售额自 2022 年一季度开始下降，到 2022 年第四季度探底后呈波动趋势，并自 2023 年四季度开始快速增长。受益于人工智能、机器人等行业快速发展，全球半导体产业链需求旺盛，全球半导体销售额自 2024 年上半年突破 2021 年前高，并持续创新高，整体需求持续旺盛。

中国集成电路产业产量增长情况



由上图数据，中国集成电路产业产量由 2021 年的 3,594.30 亿块变动至 2022 年的 3,241.90 亿块，同比下降约 9.80%；2023 年产量约 3,514.40 亿块，同比增长约 8.41%；2024 年产量约 4,514.20 亿块，同比增长约 28.45%；2025 年产量约 4,843.00 亿块，同比增长约 7.28%，整体呈现先调整后恢复的周期性变化特征。

2022 年以来，受全球宏观经济波动及终端消费电子需求下行影响，行业进入调整阶段，下游需求收缩带动产业链进入去库存周期，行业整体盈利水平承

压。自 2024 年一季度起，公司所处的封测行业景气度企稳回升，市场需求逐步复苏，与全球半导体销售额变动趋势一致。

2021 年，公司受益于行业终端市场的高景气度实现了营业收入的快速增长。2022 年后封装测试行业受终端市场景气度下滑和半导体企业去库存影响，行业公司的产能利用率、销量和产品价格均出现不同程度下滑。受行业周期性影响，公司的产品价格大幅下滑，虽行业景气度于 2024 年开始回升，公司产品的价格水平有所回升，但较 2021 年的高点仍存在差距。

2、产能利用率和产销率

2023 年至 2025 年，公司产能、产量及销量情况如下所示：

期间	类别	产能	产量	销量	产能利用率	产销率
2025 年	封装测试(亿只)	134.82	119.34	119.68	88.52%	100.28%
	晶圆测试(万片)	15.66	9.56	8.28	61.05%	86.56%
2024 年	封装测试(亿只)	134.02	107.98	105.71	80.57%	97.90%
	晶圆测试(万片)	7.90	4.30	4.10	54.43%	95.35%
2023 年	封装测试(亿只)	131.71	89.74	89.82	68.13%	100.09%
	晶圆测试(万片)	4.32	1.10	0.96	25.46%	87.27%

2021 年，公司产品为集成电路封装测试，尚未开展功率器件封装测试和晶圆测试业务，2021 年公司集成电路封装测试产量为 103.41 亿只。2025 年，公司封装测试产能提升至 142.18 亿只，封装测试产能利用率由 2023 年的 68.13% 提升至 2025 年的 88.52%，晶圆测试产能利用率由 2023 年的 25.46% 提升至 2025 年的 61.05%，整体的业务运营态势良好。

2021 年，公司实现主营业务收入 78,013.54 万元，其中 DFN/QFN 产品收入为 17,710.71 万元；DFN/QFN 为公司的中高端产品，基于其引脚数量较多和技术难度较高，每小时产出量低于 SOP 和 SOT 系列产品，价格较 SOP 和 SOT 系列产品具有优势。在产品价格下降的背景下，2024 年和 2025 年公司 DFN/QFN 产

品收入分别为 20,099.06 万元、25,181.57 万元，实现了中高端产品收入的持续增长，受益于公司通过持续投入机器设备扩充了中高端产品 DFN/QFN 的产能。

2023 年公司产能利用率不足主要受下游市场需求低迷影响。2024 年起，随着终端行业需求和半导体行业需求逐步复苏，公司产品销量提升，公司产能利用率逐年提升。半导体封装测试业务基于其产品种类众多，不同产品在手订单量存在差异，行业公司持续扩充产能等综合因素影响，产能利用率在 80%以上属于较高水平，公司 2024 年和 2025 年公司封装业务产能利用率和产销率均保持在较高水平。

3、新增固定资产情况

2021 年末、2023 年末至 2025 年末，公司固定资产具体情况如下：

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	34,473.75	38,619.73	16,905.07	15,055.57
房屋建筑物装修	16,459.86	15,009.52	11,777.92	8,405.73
机器设备	157,345.76	149,837.18	134,918.82	98,895.83
通用设备	7,869.62	7,229.73	6,396.41	4,639.00
运输工具	264.32	275.10	275.10	237.31
其他设备	6,567.82	6,290.52	5,463.82	3,785.28
原值合计	222,981.13	217,261.78	175,737.15	131,018.73

由上表，2023 年末，公司固定资产较 2021 年末增加 44,718.42 万元，主要系机器设备增加 36,022.99 万元。2023 年末至 2025 年末，公司固定资产原值分别为 175,737.15 万元、217,261.78 万元、222,981.13 万元，其中机器设备原值分别为 134,918.82 万元、149,837.18 万元、157,345.76 万元，通用设备原值分别为 6,396.41 万元、7,229.73 万元、7,869.62 万元，固定资产、机器设备和通用设备规模持续增加。公司机器设备整体成新率为 54.26%，使用状况良好。

(1) 房屋及建筑物新增情况

2024 年末，公司房屋及建筑物较 2023 年末增加 21,714.66 万元，主要系二期厂房工程转固所致。二期厂房于 2025 年 11 月 14 日获取房产证，建筑面积为 87,894.96 平方米。二期厂房的投入使用满足了公司持续投入机器设备扩充产能

的场地需求。

(2) 持续投入机器设备的合理性分析

公司所处的半导体封装测试行业受下游终端市场需求影响，具有较强的周期性，通常一个完整的周期为 3-5 年；同时，半导体封装测试设备国内厂家水平仍较国外企业具有较大差距，特别是减薄划片、键合等部分封装环节设备基本只有国外企业可以供给，在行业景气度高企的时候，设备厂家交付周期延长，因而通常情况下，半导体封装测试企业在行业景气度差的情况下，也会根据对行业周期变化的预判并结合自身发展战略，进行产能规划和固定资产投资。

从公开披露信息来看，国内半导体封装测试企业 2023、2024、2025 年度机器设备金额均有所增加，变动情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年末	2024 年末	2023 年末	增长额 (2025vs2024)	增长额 (2024vs2023)	增长额 (2023vs2022)
长电科技	4,177,059.58	3,858,916.28	3,395,003.03	318,143.30	463,913.25	133,936.71
通富微电	3,795,495.42	3,074,147.88	2,668,372.31	721,347.54	405,775.56	402,972.53
华天科技	2,896,956.67	2,504,879.44	2,226,315.06	392,077.23	278,564.38	156,608.21
甬矽电子	815,978.50	652,454.73	456,924.57	163,523.78	195,530.16	127,033.97
气派科技	165,215.38	157,066.91	141,315.23	8,148.47	15,751.68	15,289.95

注 1：华天科技机器设备金额包含固定资产中的专用设备和通用设备；

注 2：甬矽电子机器设备金额包含固定资产中的专用设备和通用设备；

注 3：公司机器设备金额包含固定资产中的机器设备和通用设备。

从上表可知，国内半导体封装测试企业 2023、2024、2025 年度均新增了较多的机器设备，公司报告期内固定资产的变动趋势与同行业可比公司不存在较大差异。行业内企业纷纷加大设备投入，主要是基于以下方面：

① 下游市场新需求不断涌现为行业提供广阔市场空间

集成电路行业的发展主要取决于下游的终端应用领域。集成电路行业属于周期性行业，从历史经验看，每个完整周期一般持续 3-5 年，集成电路行业伴随着下游市场新需求的不断涌现处于一个震荡上升的趋势。虽然受宏观经济环境变化的影响，2022 年以来下游市场需求放缓，行业景气度有所下降，但是 2024 年度集成电路行业景气度探底回升，随着物联网、智能家居、汽车电子、5G 通信、

人工智能等新兴领域的快速扩张，芯片的需求量将大幅度提升，为半导体封装测试行业提供了更大的市场空间。

②行业供应链本土化趋势进一步加速

在我国政府部门的大力政策支持、产业基金设立和集成电路企业自身技术水平持续进步的大环境下，行业供应链本土化趋势开始加速。此外，国内设计公司的能力不断增强和国内晶圆制造多条产线投产，为我国半导体封装测试产业发展提供了广阔空间。

② 逆周期投资可降低投资成本

在半导体行业景气度高的时候，设备厂家的设备订单增加，交期变长，设备价格也随着需求增加有所上涨。由于半导体行业属于投资金额大、投资周期长的行业，因此行业内企业为了降低投资成本、缩短设备交期，通常会选择逆周期进行投资。2022、2023 年度，伴随着行业景气度下降，行业内企业考虑到固定资产投资成本降低等因素，也加大了设备投入以扩充产能，为后续需求的增长提供了坚实的基础。

因此，行业内企业加大设备投资主要是基于未来行业市场空间不断增大，行业供应链本土化趋势带来的市场巨大且进一步加速以及产业链转移的机遇。公司 2023 年至 2025 年持续新增固定资产投资具有合理性，与同行业上市公司不存在显著差异。

除上述行业共性因素之外，公司还通过持续投入机器设备开拓了功率器件封装测试业务和晶圆测试业务，增加了中高端产品 DFN/QFN 的产能，能够满足客户的多元化和技术升级需求，提升公司自身竞争力。

4、公司在手订单情况

截至 2026 年 3 月末，公司封装测试业务在手订单为 22.32 亿只，较 2025 年末增加 5.72 亿只，较 2025 年 3 月末增加 8.84 亿只，公司持续投入固定资产扩充产能是公司承接客户日益增长的订单需求和交期的有力保障。

综上，公司 2025 年营收水平低于 2021 年主要系行业周期影响导致的终端市场

需求下滑，相应的产品价格下降，虽然行业需求于2024年开始复苏，且公司产能、产能利用率和产销量提升，但公司产品的价格水平与2021年行业峰值时的价格水平仍存在差距所导致。公司通过持续投入固定资产丰富了公司产品类型、扩充了中高端产品的产能，提升了公司整体竞争力，且与同行业公司趋势一致，具有合理性，公司现有的固定资产规模和配置与公司生产经营实际需求相匹配。

（二）结合主要产品的下游需求、产能利用率、价格及毛利率变化，说明公司主要固定资产的减值准备是否充分计提，报告期末仅计提15.92万元减值准备的合理性

1、主要产品的下游需求

公司主营业务为封装测试加工服务，是半导体产业链中生产配套的重要环节，其受制并依托于半导体产业的发展。集成电路是信息产业的基础，涉及家用电器、消费电子、移动通信、网络通信、高性能运算、工业、汽车、医疗、航空航天等各类电子设备领域，先进封装技术在上述领域也得到广泛的应用。其中，智能手机等移动终端和人工智能、数据中心、云计算、自动驾驶等高性能运算是先进封装最具代表性的下游行业，也是先进封装市场近年来增长及未来可持续发展的重要驱动因素，具体如下：

（1）高性能运算

近年来，人工智能、数据中心、自动驾驶等高性能运算产业在全球范围内迎来历史性的爆发式增长机遇，并正逐步成为先进封装行业的关键增长点和盈利点。

一方面，数字经济的快速发展已成为全球经济增长的重要推动力，并将在全球经济进一步复苏中发挥重要作用；同时，数字化变革和智能化转型也是当代企业增效发展的必由之路。随着数字技术的不断发展，数据量呈现快速增长的态势，强有力的算力支撑是实现数字技术突破和数字经济发展的关键因素。

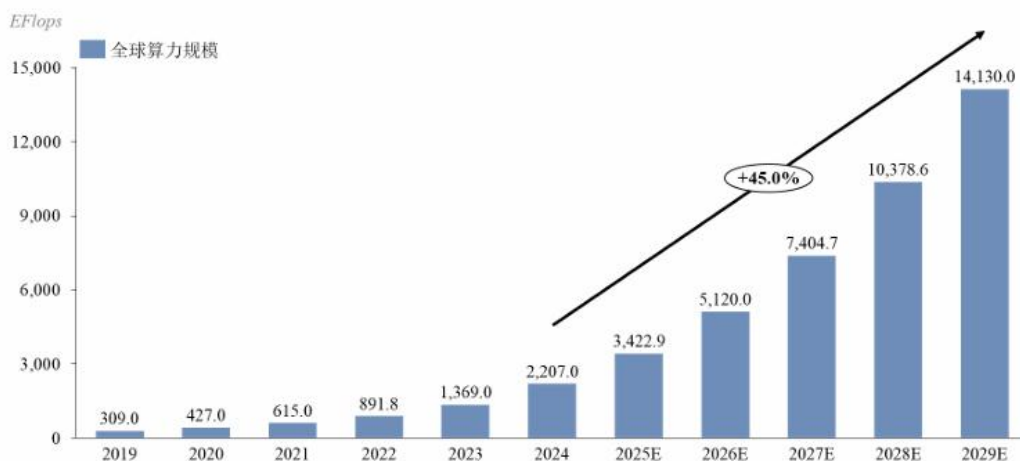
另一方面，以ChatGPT和DeepSeek为代表的生成式大模型将人工智能技术由B端推向C端，在带来了算力普惠的同时，大模型参数的指数级增加也促进了算力需求的爆发式增长，根据英伟达的统计，在大模型出现之前，算力需求每两年

增长约8倍，在大模型出现之后，这一增速大幅提升至每两年约275倍；根据OpenAI的预计，GPT-5所需的计算资源将较GPT-3高出200至400倍。

此外，在汽车智能化的重要发展趋势下，随着更高级别的高阶自动驾驶技术和Robotaxi模式逐步实现商业化，将重塑人类的出行方式，为移动出行产业带来变革。自动驾驶技术的进步和扩展需要处理大量增加的数据，也将带来爆发式的算力需求。

从算力规模看，全球算力规模从2019年的309.0EFlops增长至2024年的2,207.0EFlops，复合增长率为48.2%，预计全球算力规模将在2029年达到14,130.0EFlops，2024年至2029年复合增长率为45.0%。以英伟达为例，其来自数据中心的营业收入由2020财年的30亿美元快速增长至2025财年的1,152亿美元，复合增长率高达108%。

2019年至2029年全球算力规模



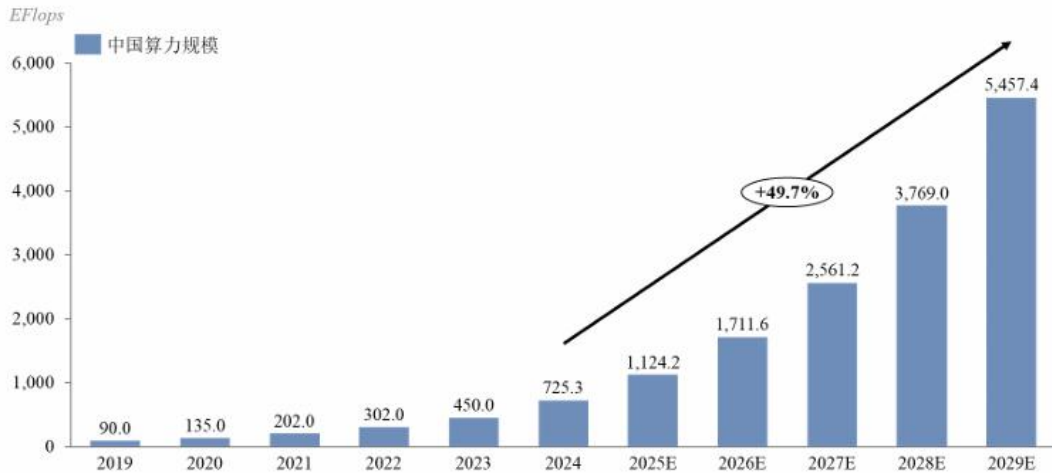
资料来源：中国信通院，灼识咨询

我国高度重视算力资源的投资和算力基础设施的建设。根据浪潮信息、清华大学全球产业研究院等发布的全球计算力指数评估报告，中国算力指数长期位居全球第二，仅次于美国，尤其在计算能力和基础设施方面具备显著优势。从算力规模看，中国大陆算力规模从2019年的90.0 EFlops增长至2024年的725.3EFlops，复合增长率为51.8%。

随着我国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程全面启动，从宏观层面优化算力基础设施布局，引导算力资源规模化、集约化和绿色化

发展,预计中国大陆算力产业将步入到高质量发展的新阶段,算力规模将在 2029 年达到5,457.4EFlops, 2024年至2029年复合增长率为49.7%。

2019 年至 2029 年中国大陆算力规模



资料来源：中国信通院，灼识咨询

(2) 智能手机

近年来,随着智能手机功能的丰富、性能的提升,以及通信制式的迭代,单台智能手机需要搭载更多数量和更多种类的芯片,各类芯片使用的主要封装技术也出现更新和发展,是先进封装行业的重要增长点。以智能手机必需的应用处理器、电源管理芯片、射频芯片和存储芯片为例,具体如下:

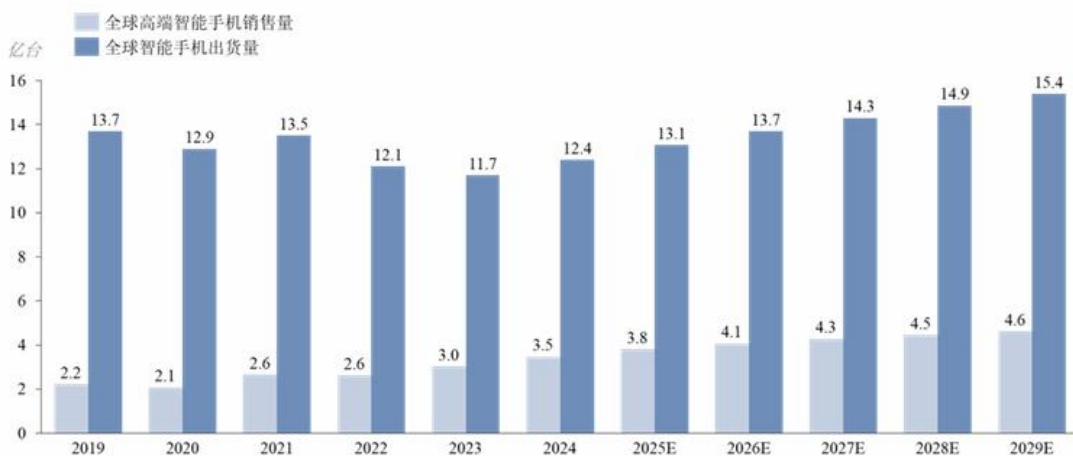
芯片类型	单台智能手机芯片数量	主要封装技术发展情况
应用处理器	1 颗, 部分机型会额外搭载基带芯片	过去主要使用 FC 技术, 苹果公司的 A 系列处理器则使用 3D Package 技术。随着智能手机功能的丰富和性能的提升, 应用处理器将更多使用到 3D Package 技术
电源管理芯片	1 颗以上	过去主要使用传统封装技术。但是, 随着智能手机电路复杂度的提升, 及对电源管理稳定性、芯片尺寸要求的提高, 电源管理芯片将更多使用到 FC、WLP 等先进封装技术
射频芯片	由于通信制式向下兼容的特点, 通信制式的迭代需要使用到更多的射频芯片, 比如, 5G 智能手机搭载的射频芯片可达到 4G 智能手机的四倍	过去主要使用传统封装技术。但是, 为契合智能手机小型化、集成化的发展方向, 同时降低信号传输时的损耗和干扰, 射频芯片将更多使用到 FC、WLP 等先进封装技术

存储芯片	为满足用户对存储容量需求的提升，智能手机需要搭载更多的存储芯片	过去主要使用传统封装技术。但是，为契合智能手机小型化、集成化的发展方向，存储芯片将更多使用到 FC、WLP 等先进封装技术
------	---------------------------------	---

从出货量看，虽然受公共卫生事件、政治经济不确定性和消费者需求下降等因素影响，2019年至2023年全球智能手机出货量总体呈现下降趋势，但是，对于单价大于600美元的高端智能手机，其出货量总体呈现稳定增长的态势。高端智能手机的功能更丰富、性能更优异、通信制式更全面，需要搭载更多使用到先进封装技术的芯片。

此外，随着厂商库存的正常化，以及折叠屏手机、AI 手机的加速渗透，全球智能手机出货量自2024年开始复苏并预计将保持增长态势。对于高端智能手机，预计其出货量将保持稳定增长。

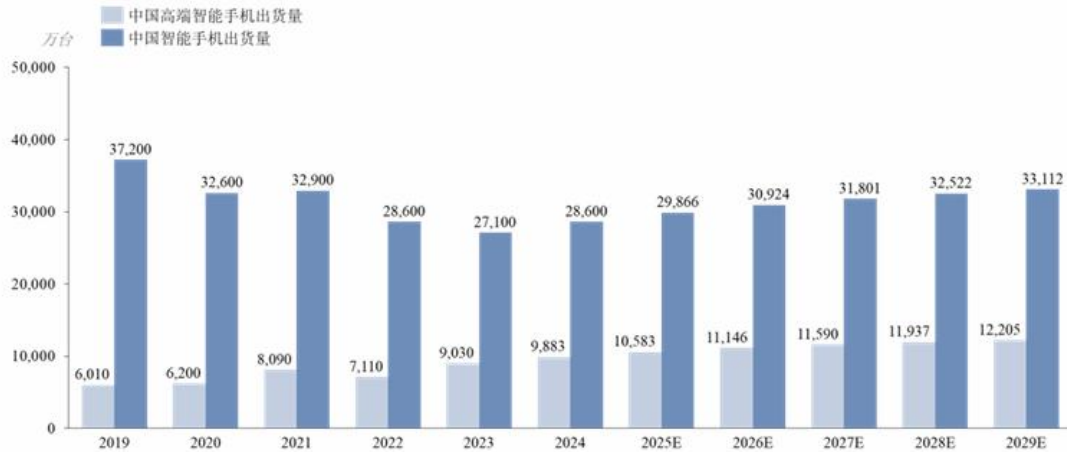
2019 年至 2029 年全球智能手机出货量



资料来源：Counterpoint，灼识咨询

与全球市场相同，2019年至2023年中国大陆智能手机出货量总体呈现下降趋势，此后，中国大陆智能手机出货量自2024年开始复苏并预计将保持增长态势。中国大陆高端智能手机出货量除2022年出现下降外，其余年度均总体呈现稳定增长的趋势。

2019年至2029年中国大陆智能手机出货量



资料来源：Counterpoint，灼识咨询

支持各种人工智能大模型的AI手机和AI PC实现了高性能运算与移动终端两大先进封装重要下游行业的融合，渗透率有望实现快速提升，根据台积电的预计，全球AI手机和AI PC的渗透率将于2027年均超过50%，具体如下：

项目	2023	2024	2025E	2026E	2027E	2028E
全球 AI 手机渗透率	6%	17%	32%	42%	56%	68%
全球 AI PC 渗透率	8%	20%	35%	43%	53%	59%

2、产能利用率

2022年度至2025年度，公司封装测试业务产能利用率分别为72.67%、68.13%、80.57%、88.52%，呈快速上升趋势。2025年末，公司封装测试业务已经处于满产状态，公司机器设备均正常投入生产，不存在设备闲置的情况。

3、主要产品的价格及毛利率

报告期内，公司封装测试业务收入主要产品单价及毛利率情况如下表：

产品名称	2025 年度			2024 年度		
	收入	单价	毛利率	收入	单价	毛利率
	(万元)	(元/pcs)	(%)	(万元)	(元/pcs)	(%)
SOT	24,357.07	0.0429	2.05%	18,633.74	0.0380	-8.97%
SOP	15,941.50	0.0647	-8.54%	16,813.43	0.0611	-22.02%
QFN/DFN	25,181.57	0.0859	8.64%	20,099.06	0.0931	8.98%
CPC	2,163.56	0.0497	-6.23%	2,073.02	0.0526	-14.22%
LQFP	529.65	0.3035	8.69%	577.92	0.3332	10.25%
MOD	2,427.71	0.1251	7.72%	2,647.32	0.1536	18.04%

PDFN	1,465.86	0.1126	34.47%	418.15	0.1478	16.01%
其他封测产品	822.73	0.0724	18.30%	1,128.02	0.0788	-12.25%
合计	72,889.64	0.0609	2.84%	62,390.67	0.0590	-5.45%

2024年下半年以来，随着半导体行业景气度的触底回升，封装测试产品销售价格逐步企稳。2025年产品价格下降趋势收窄，SOP、TO产品价格实现回暖。

2023年第四季度起，随着半导体行业AI算力芯片、汽车电子、消费电子需求韧性凸显，叠加库存去化接近尾声，半导体行业呈现温和复苏态势。2024年下半年以来，随着半导体行业景气度的触底回升，封装测试产品销售价格逐步企稳。公司在行业周期性调整出现了亏损，随着行业周期性复苏，2025年度毛利率扭负为正，经营亏损已进一步缩窄。2026年1-3月公司毛利率为10.57%，较2025年大幅度提升。

4、公司聘请评估机构对公司主要固定资产进行评估

(1) 减值测试资产组范围

由于公司近三年一期经营持续亏损，结合行业发展情况，对于公司封装测试业务所在的资产组进行减值，减值测试资产组范围如下表所示。

金额单位：人民币万元

减值测试资产组范围	2025年12月31日
固定资产-机器设备	79,823.81
固定资产-其他设备	1,932.93
固定资产-模具	2,222.05
资产总计	83,978.80
减值准备	15.92
资产净额	83,962.88

(2) 减值测试方法

根据《企业会计准则第8号——资产减值》（2006）第六条规定，“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。”

本次资产减值测试采用预计未来现金流量现值法对公司拟进行资产减值测试资产组的可收回金额进行计算。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》（2006）第12条第二款规定，“预计资产的未来现金流量不考虑筹资活动的现金流入或流出以及与所得税收付有关的现金流量。”

计算减值测试资产组预计未来现金流量现值，以减值测试资产组收益期息税前现金净流量为基础，采用税前折现率折现。

在预计未来现金流量现值模型中，息税前现金净流量的计算公式如下：

息税前现金净流量=息税前利润+折旧和摊销-资本性支出-营运资金追加额

减值测试资产组预计未来现金流量现值的计算公式如下：

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{NCF_i}{(1+r)^i}$$

其中：P：减值测试资产组预计未来现金流量现值；

NCF_i：预测期第i年息税前现金净流量；

r：税前折现率；

n：收益期；

i：预测期第i年。

（3）评估假设

在评估过程中，我们所依据和使用的评估假设是资产评估工作的基本前提，同时提请评估报告使用人关注评估假设内容，以正确理解和使用评估结论。

基本假设

1、公开市场假设，即假定在市场上交易的资产或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断；

2、交易假设，即假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，资产评估专业人员根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

特定假设

- 1、假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；
- 2、假设预测期评估对象经营符合国家各项法律、法规，不违法；
- 3、除评估基准日政府已经颁布和已经颁布尚未实施的影响评估对象经营的法律、法规外，假设收益期内与评估对象经营相关的法律、法规不发生重大变化；
- 4、假设评估基准日后评估对象经营所涉及的汇率、利率、税赋及通货膨胀等因素的变化不对其收益期经营状况产生重大影响（考虑利率在评估基准日至报告日的变化）；
- 5、假设评估基准日后不发生影响评估对象经营的不可抗拒、不可预见事件；
- 6、针对评估基准日评估对象的实际使用状况和经营情况，假设评估对象在未来收益期持续经营并使用；
- 7、除已经颁布尚未实施的会计制度，假设未来收益期内评估对象所采用的会计政策与评估基准日在重大方面保持一致，具有连续性和可比性；
- 8、假设评估对象经营相关当事人是负责的，且管理层有能力担当其责任，在未来收益期内主要管理人员和技术人员基于评估基准日状况，不发生影响其经营变动的重大变更，管理团队稳定发展，管理制度不发生影响其经营的重大变动；
- 9、假设委托人和评估对象相关当事人提供的资料真实、完整、可靠，不存在应提供而未提供、资产评估专业人员已履行必要评估程序仍无法获知的其他可能影响评估结论的瑕疵事项、或有事项等；
- 10、假设评估对象未来收益期不发生对其经营业绩产生重大影响的诉讼、抵押、担保等事项；
- 11、除评估基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设评估对象预测期不进行影响其经营的重大投资活动，企业产品生产能力或服务能力以评估基准日状况进行估算；

12、假设评估对象未来收益期内，其产能规模保持现状，不进行任何形式产能扩张性质的资本性支出，现有生产设施及技术水平可持续满足预期市场需求为假设前提；

13、假设管理层经营计划能如期实现；

14、假设评估对象预测期经营现金流入、现金流出为均匀发生，不会出现年度某一时点集中确认收入的情形；

15、2023年11月15日，气派科技股份有限公司取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202344204067号，有效期为三年，适用所得税率为15%。结合气派科技股份有限公司的研发投入、得到的研发成果等方面，假设气派科技股份有限公司的高新技术企业资质到期后能够重新获得认定，继续享受所得税15%的税收优惠，2026年11月及以后年度所得税按15%进行预测；

16、2023年12月28日，广东气派科技有限公司取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202344015846号，有效期为三年，适用所得税率为15%。结合广东气派科技有限公司的研发投入、得到的研发成果等方面，假设广东气派科技有限公司的高新技术企业资质到期后能够重新获得认定，继续享受所得税15%的税收优惠，2026年12月及以后年度所得税按15%进行预测；

17、2023年3月24日的国务院常务会议决定延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，包括将符合条件行业企业研发费用加计扣除比例由75提高至100，并作为制度性安排长期实施。根据2023年3月27日发布的《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第7号），自2023年1月1日起，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2023年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。该政策除烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业等以外，其他行业企业均可享受，气派科技股份有限公司和广东气派科技有限公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业下

属的集成电路制造业，可享受该税收优惠政策，本次评估假设该政策在收益期内可以持续实施，未来年度公司研发费用税前加计扣除比例按100%计算预测。

(4) 评估结论

经测算，在持续经营前提下，减值测试资产组可收回金额为85,256.66万元。

本次资产减值测试采用预计未来现金流量现值法对公司拟进行资产减值测试资产组的可收回金额进行计算，计算结果高于账面价值，故不需要测算公允价值减处置费用后的净额。

综上所述，公司主要产品下游需求增长，市场空间巨大，2025年度公司产能利用率回升至较高水平，结合评估机构出具的评估报告，公司固定资产减值准备已计提充分。

(三) 针对2025年末公司受限固定资产50,575.86万元的情况，列示受限固定资产的明细，包括固定资产类型（房屋及建筑物/机器设备/通用设备等）、标识（如房屋位置、设备型号等）、用途、账面金额、抵押比例、抵押作价、抵押背景等，并说明是否存在因公司无法履约导致抵押资产使用受限，对公司生产经营造成重大影响的风险

受限固定资产的明细，包括固定资产类型（房屋及建筑物/机器设备/通用设备等）、标识（如房屋位置、设备型号等）、用途、账面金额、抵押比例、抵押作价、抵押背景如下表所示：

单位：万元

固定资产类型	标识	用途	数量	账面价值	抵押比例	抵押背景
房屋及建筑物	东莞市石排镇气派科技路1号	生产经营	1.00	30,012.58	100%	获取银行授信额度
房屋建筑	东莞市石排镇气派科技路1号	生产经营	1.00	9,565.66	100%	获取银行授信额度

物装修						
机器设备	EagleAero/IHA WKAERO/iHawkAero	键合	146.00	2,545.52	100%	售后回租
机器设备	AD3000T/DFD 6361/PG300R M/TS-PRO	磨划	14.00	969.74	100%	售后回租
机器设备	AR9000/FMS3 040/microSAW VISIONPLACEMENT6.0D/ VISIONPLACEMENT- 6.0DSUPREME/SOT23- 12R/SOT23-24R	切割分离	26.00	1,924.78	100%	售后回租
机器设备	Cheetah/NTAM S120-4PS	塑封	2.00	240.03	100%	售后回租
机器设备	AD8312FC/AD 8312Plus/AD832/ AD832I/HX3600/HX3600A/ Lotus12/Lotus-Eplus	装片	107.00	5,317.55	100%	售后回租
合计			297.00	50,575.86		

单位：万元

金融机构	抵押作价	抵押背景
中关村科技租赁股份有限公司	5,500.00	售后回租
深圳市中小担融资租赁有限公司	3,000.00	售后回租
日盛国际融资租赁有限公司东莞分公司	1,000.00	售后回租
仲信国际融资租赁有限公司	1,000.00	售后回租
平安国际融资租赁有限公司	2,200.00	售后回租
中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行	16,000.00	售后回租
中国银行股份有限公司东莞分行	29,700.00	售后回租
合计	58,400.00	

公司固定资产主要系银行贷款及售后回租抵押所产生，上述存在抵押的借款及售后回租均正常还款，无逾期尚未支付的银行借款及售后回租款项，报告期内，

公司不存在因公司无法履约导致抵押资产使用受限,对公司生产经营造成重大影响的风险的情形。

(四)列示报告期内由固定资产转入投资性房地产的具体资产明细,包括资产名称、坐落位置、建筑面积、资产原值、累计折旧、减值准备、转换日账面价值、转换日及确定依据,对照《企业会计准则》有关投资性房地产的确认条件,说明公司转换条件、转换时点的判断依据是否充分

1、报告期内,公司固定资产转入投资性房地产具体明细如下所示:

单位:万元

固定资产名称	坐落位置	建筑面积	转入投资性房地产面积	资产原值	累计折旧	减值准备	转换日账面价值	转换日	确定依据
生产厂房(二期)	气派科技园二期生产大楼十一楼东面区域	87,894.96	4,064.00	971.57	13.13	-	958.45	2025年8月1日	以实际出租日期确定
食堂及宿舍	气派园区宿舍(204、206、208)	26,464.81	113.40	24.41	1.38	-	23.03	2025年8月1日	以实际出租日期确定
生产厂房(二期)	气派科技园二期生产大楼九楼整层区域	87,894.96	7,388.75	1,766.41	24.27	-	1,742.14	2025年8月1日	以实际出租日期确定
生产厂房(二期)	气派科技园二期生产大楼六楼整层区域	87,894.96	7,175.71	1,715.48	30.24	-	1,685.24	2025年10月1日	以实际出租日期确定
食堂及宿舍	气派园区宿舍(631)	26,464.81	37.80	8.14	0.43	-	7.71	2025年11月26日	以实际出租日期确定

公司以实际出租日期作为转换日,按租赁面积计算投资性房地产转化日的账面价值,根据企业会计准则以及应用指南的规定:公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量;投资性房地产原值占固定资产原值的比例为2.60%,占比较低。

2、公司的投资性房地产是否符合投资性房地产的确认条件具体情况如下：

投资性房地产确认条件	公司投资性房地产情况
符合投资性房地产的概念（转换条件）	自用建筑物停止自用，改为出租
与该投资性房地产相关的经济利益很可能流入企业	公司的投资性房地产出租并获取租金收入
与该投资性房地产的成本能够可靠地计量	公司的投资性房地产通过成本模式计量，按照其从固定资产转出厂房比例在转换日的价值入账，与该投资性房地产的成本能够可靠地计量
投资性房地产应当能够单独计量和出售	公司按照出租的面积占比进行确认和计量，能够单独计量和出售

按照《企业会计准则应用指南汇编（2024）》的相关规定：已出租的建筑物是企业已经与其他方签订了租赁协议,以经营租赁方式出租的建筑物。一般应自租赁协议规定的租赁期开始日起,经营租出的建筑物才属于已出租的建筑物，故公司以租赁开始日作为转换日符合《企业会计准则》的相关规定。

综上所述，对照《企业会计准则》有关投资性房地产的确认条件，公司投资性房地产的转换条件、转换时点的判断依据充分的。

（五）量化分析上述固定资产转为投资性房地产对公司2025年财务报表的具体影响，如折旧/摊销金额、营业成本及管理费用、全年净利润等的影响金额

2025年投资性房地产计提的折旧金额为72.58万元，金额较小；公司投资性房地产转换前采用成本模式计量，相应的折旧遵循固定资产折旧政策，转换后也采用成本模式计量，折旧也遵循固定资产折旧政策，转换前后均采用成本模式计量，折旧政策也未发生改变，出租前对应的固定资产折旧计入管理费用，出租后对应的投资性房地产计入营业成本，对2025年的净利润无影响。

（六）结合公司2025年产能利用率上半年较低、下半年有所恢复的经营背景，说明公司将二期厂房转为出租而非自用的具体原因及商业合理性。

2023年至2025年，公司封装测试和晶圆测试产能利用率情况如下：

期间	类别	产能	产量	产能利用率
2025年	封装测试（亿只）	134.82	119.34	88.52%

期间	类别	产能	产量	产能利用率
	晶圆测试（万片）	15.66	9.56	61.05%
2024 年	封装测试（亿只）	134.02	107.98	80.57%
	晶圆测试（万片）	7.90	4.30	54.43%
2023 年	封装测试（亿只）	131.71	89.74	68.13%
	晶圆测试（万片）	4.32	1.10	25.46%

2023年至2025年，公司封装测试产能利用率分别为68.13%、80.57%和88.52%，晶圆测试产能利用率分别为25.46%、54.43%和61.05%，整体呈上升趋势。2025年，公司封装测试产能利用率为88.52%，较2024年进一步提升；其中，2025年上半年封装测试产能利用率为86.31%、2025年下半年封装测试产能利用率为90.37%，下半年较上半年有所提高。2025年上半年产能利用率相对较低，主要系春节假期因素影响，生产经营有效工作天数相对减少，产线开工率及产能利用率阶段性下降；下半年随着下游需求恢复、订单交付增加，现有产线稼动率有所提升。

2025年下半年以来，公司经营情况明显好转，业务订单持续增长，现有设备利用率逐步提升，公司具备进一步扩充产能的现实需求。但半导体封装测试产能扩充不仅取决于厂房空间，还需要配套进行生产设备购置、安装调试、人员配置、工艺导入及客户验证等工作，相关新增设备投入金额较大，且公司资金安排需结合经营现金流、融资进度及投资计划统筹推进。因此，在产能利用率提升的背景下，公司虽具备后续扩产需求，但短期内难以将二期厂房全部空间同步转化为实际生产产能。

同时，房屋建筑物具有建设周期长、一次性规划投入规模较大的特点。公司二期厂房建设时系结合未来3-5年业务发展、产线扩展及募投项目实施需求进行整体规划，可用建筑面积较大，在满足现有生产经营及后续产能扩张空间需求的基础上，仍存在部分短期内暂未投入生产使用且相对独立的区域。为提高资产使用效率、降低阶段性闲置成本，公司在不影响现有生产经营和后续扩产安排的前提下，将其中部分区域对外出租并取得租金回报。

综上，公司将二期厂房部分区域对外出租，系基于产能扩充节奏、资金安排及厂房空间分阶段使用等因素作出的合理安排。2025年下半年以来，公司订单规模增长、产能利用率提升，后续仍存在产能扩张需求；但产能扩充不仅取决于厂

房空间，还需要结合设备购置、安装调试、人员配置、工艺导入及客户验证等因素逐步推进，厂房空间投入使用与实际产能形成之间存在一定时间差。因此，公司对短期内暂未纳入生产使用计划的相对独立区域进行阶段性出租，有助于提高资产使用效率、获取合理租金收益，与公司产能利用率提升及后续扩产计划不存在冲突，不影响公司现有生产经营及后续产能扩张安排，具有商业合理性。

（七）会计师核查程序

针对上述事项，会计师执行了以下核查程序：

1、了解公司固定资产内部控制相关制度，分析与评估相关内部控制关键设计的有效性，并执行运行有效性测试；

2、获取公司固定资产明细表，了解报告期内新增主要固定资产情况；

3、检查固定资产折旧政策和方法是否符合相关会计准则的规定，对比同行业公司固定资产折旧政策和方法，检查采用的折旧方法是否能合理分摊固定资产成本，预计的使用寿命和预计净残值是否合理，并对主要固定资产折旧执行复核计算的程序，以验证折旧计提的准确性；

4、实施固定资产监盘，实地查验房屋建筑物状态、通用设备、运输工具、专用设备运行状况，核查房屋权证等资产权属文件，确认公司固定资产实际状态、资产真实性等；

5、查阅公司固定资产明细表，对报告期内大额新增固定资产、在建工程进行抽查，检查相应的工程预算资料、立项申请、合同、购买审批记录、付款单据、发票、验收单；

6、访谈公司管理层，了解厂房出租的原因及商业合理性；

7、与管理层讨论资产负债表日固定资产减值迹象，复核减值准备计提依据，分析与判断公司固定资产减值计提的充分性，检查相关会计处理的准确性。

8、检查固定资产受限情况；

9、对公司固定资产转入投资性房地产的确认条件、转换时点进行分析确认，以及会计处理是否正确。

（八）会计师核查结论

经核查，会计师认为：

1、结合行业周期、产能利用率、产销率，以及近年来新增固定资产运营情况分析，公司固定资产增加但营业收入下降具有合理性，固定资产与公司生产经营实际需求相匹配；

2、2025 年公司下游需求旺盛，产能利用率较大幅度提升、产品的单位售价和毛利率均有所上升，同时公司聘请评估机构对主要固定资产进行评估，经上述分析及评估机构出具的评估报告，公司主要固定资产减值准备计提充分，报告期末仅计提 15.92 万元减值准备具有合理性；

3、2025 年末公司受限固定资产均为售后回租和银行授信抵押所产生，公司按时偿还售后回租款和银行借款，不存在无法履约导致抵押资产使用受限，对公司生产经营造成重大影响的风险。

4、公司报告期内固定资产因出租，故在出租日将其转入投资性房地产，符合《企业会计准则》有关投资性房地产的确认条件

5、公司投资性房地产转换前采用成本模式计量，相应的折旧遵循固定资产折旧政策，转换后也采用成本模式计量，折旧也遵循固定资产折旧政策，转换前后均采用成本模式计量，折旧政策也未发生改变，出租前对应的固定资产折旧计入管理费用，出租后对应的投资性房地产计入营业成本，对 2025 年的净利润无影响。

6、关于二期厂房转为出租而非自用的商业合理性，公司将二期厂房部分区域对外出租，系在产能利用率阶段性恢复、厂房空间分阶段投入使用的背景下，对短期内暂未纳入生产使用计划的相对独立空间进行合理资产盘活，有助于提高资产使用效率、降低闲置成本。相关出租安排与公司产能恢复及扩产计划不存在冲突，不影响公司现有生产经营及后续产能扩张安排，具有商业合理性。

五、关于研发人员及研发费用

年报显示，2025 年末公司研发人员 195 人，较期初减少 38 人，减少比例 16.31%。从研发人员学历看，本科研发人员 101 名，较期初减少 23 名；从年龄看，30 岁以下研发人员 93 名，较期初减少 32 人。另外，年报第三节“研发人员情况”表格显示，报告期研发人员薪酬合计 3,096.02 万元，而年报第七节“研发费用”表格显示，研发费用中“职工薪酬”为 2,744.14 万元，二者存在差异。研发费用中，直接材料投入 978.03 万元，同比增加 41.83%。

请公司：（1）说明研发人员的认定标准及依据，是否存在非全时研发人员，若存在，说明非全时研发人员的数量及其从事研发工作的平均工时占比；（2）说明研发人员大幅减少的具体原因，重点说明本科以及 30 岁以下研发人员大幅减少的原因，是否存在人才流失的情况，以及对公司在研项目及技术竞争力的影响；（3）说明研发人员减少的方式（如主动离职、协商解除劳动合同、调至其他岗位、认定为非研发人员等），对于离职等解除劳动合同情形，说明是否已履行必要的劳动用工程序；（4）说明“研发人员薪酬合计”与研发费用明细中“研发人员工资薪酬”存在差异的原因；（5）结合研发材料的具体内容、主要采购对象、用途及与生产领料的区分依据，说明是否存在将生产成本列入研发费用的情形，说明研发人员大幅减少的情况下，研发材料投入大幅增加的合理性。

回复：

（一）说明研发人员的认定标准及依据，是否存在非全时研发人员，若存在，说明非全时研发人员的数量及其从事研发工作的平均工时占比

研发人员认定标准及依据：公司将从事研发工作且研发工时占其考勤工时比重超过 50%的人员界定为研发人员。

公司研发人员分为全职研发人员和兼职研发人员。公司研发项目主要为应用型研发，研发过程中会开展材料验证、产品试制等工作，该等研发工作需要上机操作，同时，公司业务规模持续快速增长，产品品类逐渐丰富，研发活动工作量大，仅靠专职研发人员难以按照要求完成全部研发工作，因而部分人员既参与研发活动、又开展与研发活动不相关的生产经营活动。对该等人员，公司在其参与

研发工作工时占比超过 50%时，将其认定为兼职研发人员；参与研发工作但研发工作工时低于 50%时，公司不将其认定为研发人员。

2025 年末，公司兼职研发人员为 27 名，人数较少。2025 年度，公司兼职研发人员从事研发工作的工时占比 14.13%，占比均较低，公司兼职研发人员从事研发工作的工时占其全部工时的比例均超过 50%，兼职研发人员从事研发工作的平均工时占比为 59.15%，符合研发人员的认定标准。

(二) 说明研发人员大幅减少的具体原因，重点说明本科以及 30 岁以下研发人员大幅减少的原因，是否存在人才流失的情况，以及对公司在研项目及技术竞争力的影响

1、研发人员减少的原因分析

2025 年度，公司减少的研发人员主要为入司时间相对较短、实际研发工作经验尚处于积累中的中低职级研发人员。2024 年末及 2025 年末，公司研发人员情况如下：

项目	2025 年末	2024 年末
研发人员数量	195	233
30 岁以下研发人员	93	125
30-40 岁研发人员	82	85
本科研发人员	101	124

2025 年末，公司研发人员数量、本科研发人员、30 岁以下研发人员数量较 2024 年末分别减少 38 人、23 人和 32 人，公司研发人员下降的主要原因如下：

(1) 2025 年度，为提升经营效率和效果，公司进行了内部优化调整，根据研发部门人员配置、研发总需求、研发人员工作量及工作成果情况，调整减少部分研发人员；

(2) 公司地处经济发达的珠三角核心区，有学历优势且具备一定技术能力的人员可获得的机会多，公司虽已尽最大努力给予具有学历优势、入司时间较短、

较为年轻的研发技术人员薪酬、晋升机会等多方面的倾斜，但该等人员中的一部分因获得了薪酬更有竞争力的工作机会、寻找到了更大或更契合其自身职业规划的的平台等因素而从公司离职。

2、公司不存在核心研发人才流失的情况，不会对公司在研项目及技术竞争力产生不利影响

公司主营业务为半导体封装测试，研发工作主要为应用型开发设计，较少涉及基础理论研究，同时公司研发项目内容横跨电子信息工程、微电子、机械设计与制造、工艺设计、软件开发、计算机科学与技术等诸多领域，研发项目的开展及研发效率效果由研发项目团队决定，并不取决于某个研发人员特别是尚处于经验积累提升期的年轻研发人员。

2025 年末公司 30-40 岁的研发人员数量为 82 人，较为稳定。公司研发团队核心成员稳定，不存在核心研发人才严重流失的情况，公司采取了加强外招和内部培养的措施强化研发团队规模建设，能够保证公司研发人员的稳定性。

2025 年，公司多功能集成微控制单元（MCU）封装研发及产业化、超大功率扁平无引脚表面贴装器件封装技术及产业化、高密度高集成薄型 QFP 封装开发及产业化等 10 项在研项目按计划执行，未受到研发人员减少的不利影响。

2025 年，公司为继续在 SOT89 封测业务上持续保持竞争力保驾护航，完成了 LQFP10X10 的 BOM 考核和工艺验证、TSOT23-6Z 和镀镍锡工艺量产，成功立项了 FC-QFN 先进封装项目并获得多家客户的合作、立项了高密度大矩阵的薄型 QFP 封装项目和 LQFP 封装项目。

在功率器件封装测试方面，TO252、TO220、TO263、TO247、PDFN56、PDFN33、TO220AB 等产品持续大批量生产并展开了扩线动作以扩大产能；基于 PDFN33 封装的铝带产品工艺完成大批量生产验证，年出货量达到 1,000 万只；基于工业标准的 TO-247 封装的 SiC MOSFET 封装持续小批量交付；完成多批 PDFN56 铜夹产品的工程试制和小批量出货；完成了 TOLL 产品通线和全系列 BOM 的可靠性考核，目前已获得重要客户的认可；立项了基于 PDFN56 clip 封装的双面散热封装技术项目和用于 AI 算力芯片供电的 Dr.MOS 功率器件系统级封装测试项目。

功率器件封测规模持续扩大，技术持续更新迭代。

综上所述，公司研发人员减少主要系入司时间较短、研发经验尚处于积累提升期的年轻研发人员，使得公司存在一定的年轻研发人才流失，但公司中层研发人员特别是核心研发人员保持稳定，公司不存在核心研发人才流失的情况，不会对公司在研项目及技术竞争力产生不利影响。

（三）说明研发人员减少的方式（如主动离职、协商解除劳动合同、调至其他岗位、认定为非研发人员等），对于离职等解除劳动合同情形，说明是否已履行必要的劳动用工程序

报告期内，公司研发人员减少的方式为以下两种：员工主动离职和协商解除劳动合同，均已履行必要的劳动用工及合同关系解除程序，具体情况如下：

主动离职的研发人员均已提前以书面形式向公司递交离职申请，与公司顺利完成交接工作并签署离职确认单；公司也均已向上述离职人员出具解除劳动关系证明并配合办理档案和社会保险关系转移手续。

协商一致解除劳动合同关系的研发人员，公司在上述员工离职时均与之签订《协商解除劳动合同书》，确认公司与离职员工之间的工资、福利、社会保险等关系均已结清，不存在其它任何经济纠纷和劳动争议，员工接受公司给予的一次性解除劳动合同经济补偿金；公司均已向上述离职人员出具解除劳动关系证明（即离职确认单）并配合办理档案和社会保险关系转移手续。

综上所述，公司与员工之间解除劳动合同符合相关规定，且离职研发人员不涉及核心研发人员，核心研发人员基本稳定，离职的研发人员均已顺利完成工作交接，对公司研发工作的影响不大。

（四）说明“研发人员薪酬合计”与研发费用明细中“研发人员工资薪酬”存在差异的原因

年报第三节“研发人员情况”表格显示，报告期研发人员薪酬合计3,096.02万元，而年报第七节“研发费用”表格显示，研发费用中“职工薪酬”为2,744.14万元，两者的明细如下所示：

单位：万元

序号	项目	年报第三节 研发人员薪 酬金额	计入研发费 用的研发人 员薪酬	差异
1、	研发人员薪酬合计	3,096.02	2,773.19	322.84
	其中：全职研发人员薪酬	2,466.72	2,466.72	-
	兼职研发人员薪酬	629.30	306.46	322.84
2、	股份支付金额	-	29.92	
3、	职工福利	-	0.87	
调整后	序号 1-序号 2+序号 3	-	2,744.14	
4、	计入研发费用的研发人员薪酬	-	2,744.14	

如上表所示，两者的差异主要系兼职研发人员薪酬所致，年报第三节研发人员薪酬金额未按工时进行区分兼职研发人员薪酬，按全口径计算研发人员薪酬，而年报第七节“研发费用”是按照研发工时将兼职人员薪酬分摊计入研发费用；故两者存在差异。

（五）结合研发材料的具体内容、主要采购对象、用途及与生产领料的区分依据，说明是否存在将生产成本列入研发费用的情形，说明研发人员大幅减少的情况下，研发材料投入大幅增加的合理性

报告期内，公司研发费用中材料费用由主要材料、辅助材料以及其他材料组成，研发材料的具体内容、主要采购对象、用途如下所示：

项目	材料名称	主要采购对象	用途
主要材料	引线框、树脂、丝材等	泰兴市龙腾电子有限公司、苏州多乐思电子科技有限公司、宁波康强电子股份有限公司	开展封装设计、工艺调试与性能测试等
辅助材料	装片胶、焊锡丝、铝带等	上海盘石实业有限公司、贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司、贺利氏电子技术（苏州）有限公司	开展封装设计、工艺调试与性能测试等
其他材料	夹具、测试座	上海铭沣科技股份有限公司、深圳市瑞芯辉科技有限公司	开展封装设计、工艺调试与性能测试等

公司对生产领料和研发领料实行差异化管理。通过ERP系统在原始单据、审批流程上均实现有效区分：研发领料需选择出库类型为“研发领用”，领料单中需选择所用于的研发项目，经研发项目负责人审批，研发部门为研发部，ERP系统根据研发领料单将材料费用自动归集至研发支出。生产领料则依据产品的BOM

表自动发起或选择领用类型为“生产领料”，领料单中领料部门为生产部。两类领料在ERP系统中流程不同，不存在混同情形。研发领料与生产领料在ERP系统中实行差异化流程管理，审批路径、归集科目均有效区分，不存在混同情形。公司研发区域与生产区域严格区分，不存在研发用料和生产用料混同的情形。公司不存在将生产成本列入研发费用的情形。

报告期内，研发材料投入大幅增加的主要原因系开关电源应用的TO封装技术开发及产业化项目2025年材料费领用金额352.00万元，较2024年增加351.60万元，具体原因如下：

1、该项目较为复杂，属业内首创，过程中需要经过反复修改验证

开关电源应用的TO封装技术开发及产业化项目是突破性研发项目，TO220封装在业内大家采用的都是单排20颗产品的框架设计，为了提高工艺站点的效率公司创新采用了双排40颗的框架设计，属于业内首创，故没有可参考的经验，在开发过程中遇到较大问题需要反复修改验证，如管脚分层问题（塑封料和引线框架界面剥离）同时伴随着压力曲线异常问题，该分层在二焊点关键位置。分层会影响产品寿命。2024年底在模具试模和工艺验证时发现问题，随即启动问题分析和改善，至2025年11月基本控制住该问题，期间公司从模具排气、注塑参数、框架结构、模具流道设计、塑封料粘度等多个维度进行了数十轮改善，因不是单一因素导致的，故做了大量研究验证耗时时间较长。

2、该项目领用的研发材料单价较高

开关电源应用的TO封装技术开发及产业化项目所使用的主要材料单价较高，如引线框，该项目配套使用的引线框单位成本约0.2元~0.22元每颗，随着铜价变化而变化，正常SOP8引线框架单位成本约0.015~0.02元每颗，该项目配套使用的引线框单位成本是该引线框价格的10倍以上。SOT23引线框架单位成本约0.006~0.007元每颗，该项目配套使用的引线框单位成本是该引线框价格的31倍以上。

综上所述，研发材料的增加主要系本期研发项目所领用的材料单价较高及研发难度引起的，与研发人员的减少无相关性。

（六）会计师核查程序

针对上述事项，会计师执行了以下核查程序：

1、了解与研发费用相关的内部控制的设计及运行情况，访谈研发负责人以了解在研项目的具体进展以及了解公司是否存在非全职研发人员，分析非全职研发人员的数量及工时占比，判断合理性及相关的会计处理是否准确；

2、抽查研发费用相关凭证，包括费用相关的审批单、发票和付款单据等，检查费用真实性、准确性，并复核研发费用的会计处理是否正确；

3、了解研发人员大幅减少的原因及合理性以及研发人员的大幅下降是否会对公司的研发活动产生影响；

4、获取研发领料单，与研发费用明细账中的材料费进行核对；分析本期研发费用中材料费大幅增加的原因；

5、检查研发项目中研发人员工资分配表，结合研发人员考勤及工时表，分析计入各个研发项目的工资的准确性、完整性；

6、分析“研发人员薪酬合计”与研发费用明细中“研发人员工资薪酬”存在差异的原因及合理性。

（七）会计师核查结论

经核查，会计师认为：

1、公司在其参与研发工作工时占比超过50%时，将其认定为兼职研发人员；2025年末，公司全职研发人员为168名，兼职研发人员为27名，兼职研发人员占研发人员的比例为13.85%，占比较低。2025年度，公司兼职研发人员从事研发工作的工时占比14.13%，占比较低，公司兼职研发人员从事研发工作的工时占其总工时的平均工时比例为59.15%，符合研发人员的认定标准。

2、公司本期研发人员大幅减少的原因主要系人员离多补少所致，公司不存在核心研发人才流失的情况，不会对公司在研项目及技术竞争力产生不利影响。

3、公司研发人员减少的方式为两种：员工主动离职和协商解除劳动合同；对于离职等解除劳动合同情形，公司已履行必要的劳动用工程序。

4、“研发人员薪酬合计”与研发费用明细中“研发人员工资薪酬”存在差异的原因主要系口径不一致所致，“研发人员薪酬合计”按全口径计算非全职研发人员薪酬，研发费用明细中“研发人员工资薪酬”按非全职研发人员工时进行分配确认。

5、公司研发领料和生产领料进行了严格区分，不存在将生产成本列入研发费用的情形，研发人员的减少和研发材料投入大幅增加之间不存在必然联系，研发材料投入大幅增加主要系开关电源应用的TO封装技术开发及产业化项目研发难度较强，需要经过反复修改整改且该公司所使用的主要材料单价较高所致。

气派科技股份有限公司

2026年7月4日